

業 務

我們的使命

專注半導體及印刷電路板（「PCB」）製造領域所用等離子處理設備的研發與製造創新，推動中國高科技電子產業國內產業鏈的自主發展。

我們是誰

我們是在中國享有重要市場地位的等離子處理設備製造商，專業從事PCB及半導體製造等高科技電子領域使用的等離子處理設備的研發、製造與銷售，業務遍佈中國內地、東南亞、北美洲及歐洲等地。根據弗若斯特沙利文報告，按2023年至2025年各年度於中國產生的收入計，我們在中國PCB等離子除膠渣設備市場排名前三。同樣根據弗若斯特沙利文報告，按2025年於中國產生的收入計，我們在中國PCB等離子處理設備的市場份額約為3.6%。憑借我們在等離子處理技術方面的專業知識，我們戰略性地集中資源及開發力量，擴大我們在用於半導體製造領域的等離子處理設備的能力及市場佔有率。

我們的設備主要包括(i)廣泛應用於PCB製造、消費電子及其他行業的等離子除膠渣設備，以及用於PCB製造的輔助設備；(ii)半導體干法去膠設備及干法刻蝕設備，以及用於半導體封裝的等離子除浮渣設備；及(iii)用於等離子除膠渣設備的上下料設備。我們亦為客戶提供用於等離子處理設備的零部件及配件，以及維修及維護服務。我們提供具備定製功能的設備，與客戶生產流程深度契合，以滿足下游客戶的廣泛應用需求。

- 我們一直致力於研發應用於PCB製造及其他行業的產品，並已開發出全系列等離子除膠渣設備，旨在強化生產與維護中的表面處理工藝。我們的設備可以有效去除產品表面污染物和氧化層，提高焊接和粘合性能，這對提升PCB的性能及可靠性至關重要。
- 我們亦致力於研發及製造用於半導體封裝的等離子除浮渣設備、整平設備及撕膜設備製造。基於對半導體製造領域高精度加工設備需求增長的洞察，我們於2023年3月將提供的產品擴展至干法去膠設備及干法刻蝕設備。這些產品依託我們近20年的等離子處理技術積澱，可滿足先進半導體製造工藝的嚴苛要求。

我們以干法去膠設備及干法刻蝕設備為代表的用於半導體製造工藝的產品能有效滿足先進半導體製造的要求，在準確度、可靠性上均有著優良表現。刻蝕是半導

業 務

體圖案化過程的核心工藝，干法刻蝕設備主要用於去除特定區域的材料來形成微小的結構圖案，被稱為半導體製造核心設備之一，價值量高，市場規模可觀。除干法刻蝕設備外，干法去膠設備亦是半導體刻蝕環節的重要設備。

我們的業務模式

憑藉我們在等離子處理技術方面的專業能力，我們為PCB製造、半導體、消費電子及其他高科技電子領域的應用提供多樣化的等離子處理設備組合，以滿足下游客戶對先進高效的處理設備的需求。我們的資深技術人員在深入了解客戶的需求後，基於傳統處理技術和設備進行改良，並精心設計和研發高性能的處理設備。我們的生產基地既能生產滿足客戶非標準化需求的定製設備，也能製造標準化的先進工藝設備，以滿足下游客戶的多樣化需求。

此外，我們可根據客戶需求提供設備維修及維護服務。除了就所售產品在保修期內提供安裝、定期檢查及維護服務外，我們還為超出保修期的產品提供收費的維修和維護服務。鑒於我們的技術和生產能力，應客戶要求，我們還被客戶聘請為其從同行企業購買的用於PCB製造的等離子處理設備提供維修和維護服務。

於往績記錄期間，我們的收入主要來自(i)銷售應用於PCB製造及其他行業的等離子除膠渣設備，主要包括等離子除膠渣設備，以及用於PCB製造的輔助設備；(ii)銷售應用於半導體製造的等離子處理設備，主要包括干法去膠設備及干法刻蝕設備，以及用於半導體封裝的等離子除浮渣設備；(iii)銷售用於等離子除膠渣設備的上下料設備；(iv)銷售用於等離子處理設備的零部件及配件；及(v)提供等離子處理設備的維修及維護服務。

用於PCB製造及其他應用領域的設備

我們的用於PCB製造及其他高科技電子應用領域的產品主要作用於PCB、消費電子產品及其他行業產品的除膠渣工藝及維護。我們的等離子除膠渣設備可實現精細材料及電子元器件的表面清潔、活化、塗層處理等功能，並具備複合處理的能力，可有效提高生產效率、產品質量及產線自動化水平。我們用於PCB製造及其他高科技電子應用領域的主要設備包括：

- 用於PCB製造的等離子除膠渣設備：主要包括用於PCB材料孔內鑽污去除、PTFE材料活化處理及其他領域的5G Fermat等離子設備，以及專為軋制FPC的孔內鑽污去除和表面清潔而設計的卷對卷等離子處理設備。

業 務

- 用於其他應用領域的等離子除膠渣設備：可提供應用於消費電子、汽車電子零件及顯示面板電子元件的半導體級精密清潔設備。

用於半導體製造的設備

我們用於半導體製造的等離子處理設備主要應用在集成電路、功率半導體、化合物半導體的刻蝕、去膠及封裝工藝，並支持科學研究。我們用於半導體製造的等離子處理設備能同時兼容多種晶圓尺寸，包括4英吋、6英吋、8英吋及12英吋晶圓，適用光刻膠、聚酰亞胺、氧化硅、氮化硅、氮氧化硅、單晶硅、多晶硅等多種材料，可實現等離子干法去膠及刻蝕等多種功能。我們用於半導體製造的主要產品包括：

- 干法去膠設備：我們的干法去膠設備包括SDU-2000、SVU-2000等產品，支持4、6、8、12英吋全譜系規格晶圓，具有晶圓表面因等離子造成的損害小、高去膠率、高通量和延長的清洗平均間隔時間等特點。
- 干法刻蝕設備：我們的干法刻蝕設備主要指SEC-200，支持4、6、8、12英吋全譜系規格晶圓，適用接觸孔刻蝕、鈍化層刻蝕、硬掩模刻蝕、對準標記刻蝕等多種工藝，具有刻蝕速率高、均勻性好等特點。
- 半導體封裝設備：可提供一系列用於半導體封裝的等離子除浮渣設備、整平設備及撕膜設備，覆蓋各種封裝類型的工藝，如球柵陣列封裝、晶片級封裝、平面網格陣列封裝和針柵陣列封裝工藝。

用於等離子除膠渣設備的上下料設備

上下料設備是一款專為等離子除膠渣設備設計的PCB板全自動上下料設備，可促進前後工序之間的工作流連接。作為等離子除膠渣設備應用場景中上下游生產工序間的智能樞紐，上下料設備具備高精度、高效率的PCB板自動化搬運能力。我們的上下料設備在配置上具備靈活性，最多可同時與四台等離子除膠渣設備協同工作。這大幅優化了多設備協同的生產效率，最大限度減少人工操作，並提高了操作效率。

零部件及配件

於往績記錄期間，我們在生產基地進行生產，並向客戶銷售設備所用的零部件及配件，作為設備銷售的補充。我們生產及銷售的零部件及配件主要包括石英玻璃、真空泵、電機組件、中頻電源、柔性電路夾具、天線組件、微波匹配器及氧化鋁管。該等零部件及配件

業 務

通常用於更換設備運行過程中磨損或損壞的部件，從而有助於延長設備的使用壽命並保持穩定的性能。通過及時提供兼容的替換零件，我們不僅旨在提高設備的運行效率和可靠性，還通過全面的售後支持增強客戶忠誠度和滿意度。

維修及維護服務

於往績記錄期間，我們向客戶收取服務費以就超過保修期的產品提供維修及維護服務。鑒於我們的技術和生產能力，應客戶要求，我們還被客戶聘請為其從同行企業購買的等離子處理設備提供售後服務。

我們的市場機遇

我們處在一個需求龐大穩定且增長潛力強勁的市場。

用於PCB、消費電子及其他行業的等離子除膠渣設備需求穩定

消費電子、汽車電子及通信等下游行業需求持續增長，推動PCB製造行業實現穩健發展。根據弗若斯特沙利文報告，全球PCB產值從2020年的人民幣4,687億元增長至2025年的人民幣5,593億元，複合年增長率達3.6%；預計至2030年將增長至人民幣7,064億元，2025年至2030年複合年增長率為4.8%。這之中，受益於全球PCB產能向中國內地地區轉移以及下游蓬勃發展的電子終端產品製造，中國PCB市場佔據主要地位並保持同步增長態勢。根據弗若斯特沙利文報告，中國PCB產值從2020年的人民幣2,520億元增長至2025年的人民幣3,674億元，複合年增長率達7.8%；預計至2030年將增長至人民幣4,877億元，2025年至2030年複合年增長率為5.8%。

在電子信息技術日新月異，電子產品更新換代速度加快的大背景下，新一代的電子產品朝著微型化、輕便化和多功能方向發展。等離子處理設備憑借其在清洗、活化、塗層處理等方面的優異性能，在PCB及其他電子產品的生產及維護環節的重要性愈發凸顯，市場需求穩定增加。根據弗若斯特沙利文報告，中國應用於PCB的等離子處理設備市場規模從2020年的人民幣11億元增長至2025年的人民幣13億元，複合年增長率達7.6%；預計至2030年將增長至人民幣21億元，2025年至2030年複合年增長率為10.1%。

用於半導體製造領域的等離子處理設備的市場潛力

隨著高端量產芯片的製造工藝從14nm到10nm階段，並向7nm、5nm甚至更小的方向發展，傳統沉浸式光刻機受光波長的限制，無法滿足關鍵器件的關鍵尺寸要求。採用多重模板工藝，干法刻蝕技術克服沉浸式光刻機的技術局限，實現了更小尺寸芯片的生產，凸顯了刻蝕技

業 務

術及干法刻蝕設備的關鍵作用。根據弗若斯特沙利文報告，全球半導體干法刻蝕設備市場規模從2020年的人民幣1,057億元增長至2025年的人民幣2,048億元，複合年增長率達14.1%；預計至2030年將增長至人民幣3,110億元，2025年至2030年複合年增長率為8.7%。

由於干法刻蝕工藝較為複雜，技術壁壘較高，全球市場仍由知名國際廠商主導。長期以來，中國半導體製造商在生產中高度依賴進口干法刻蝕設備，按中國海關總署數據，2021年中國干法刻蝕設備進口規模達人民幣308億元，並在2024年進一步增至人民幣375億元。自2022年以來，受行業週期以及相關出口禁令的影響，中國干法刻蝕設備進口經歷了顯著波動。在該等背景下，中國政府出台多項利好政策推進刻蝕技術的自主研發，以期實現中國在半導體刻蝕技術領域的自主可控。根據弗若斯特沙利文報告，中國半導體干法刻蝕設備市場規模從2020年的人民幣266億元增長至2025年的人民幣679億元，複合年增長率達20.6%；預計至2030年將增長至人民幣906億元，2025年至2030年複合年增長率為5.9%。在中國半導體刻蝕設備市場中，國產設備的市場份額佔比從2020年的19.6%提升至2025年的27.8%，並預期將在2030年進一步提升至31.3%

我們的價值

我們致力成為中國領先的擁有高度自主知識產權的等離子處理設備製造商，推動中國高科技電子產業國內產業鏈的發展。我們相信，我們的產品可以創造以下價值：

賦能下游客戶

- **更高的生產效率。**我們基於客戶需求定製開發產品，可深度契合客戶的應用場景及生產流程，並與現有系統及生產流程實現無縫銜接。我們的產品具有易操作、產能高、清洗平均間隔時間長等特點，客戶使用我們的產品可在生產效率、產線整體產能及流轉速度等方面實現顯著提升。
- **更可靠的產品性能。**我們的產品均基於我們多年積累的成熟技術和專業知識打造。我們的設備擁有科學的架構設計，具有自動化程度高、控制性能優異、穩定性強等特點，對PCB、晶圓等材料表面損傷小，可實現穩定產出並保證產品良率及一致性。
- **更低的維護成本。**我們注重產品質量及耐用性，通過科學產品設計及高標準質量管控，致力向客戶交付可靠性高、易維護、使用壽命長的產品。得益於此，我們的產品在生產環節能長時間穩定地工作，客戶在使用過程中無需採取過多的維護和檢修工序，實現低維護成本運營。

業 務

推動產業鏈

- 不斷豐富的產品矩陣。我們的定製產品除了向目標客戶銷售，我們的標準化產品能夠滿足絕大多數下游客戶的常規需求。我們的產品能夠在同一台設備內進行多道工序，從而使客戶避免因重複購入相似功能設備而造成成本浪費，降低生產成本的同時優化產線佈局。因此，我們的產品亦可在投放市場後逐步被其他客戶所採用，並不斷鞏固我們在市場上的市場份額。截至最後實際可行日期，我們已開發出多種等離子處理設備，並將在未來推出金屬刻蝕、多晶硅刻蝕及PECVD設備等新型設備，極大豐富了行業內產品供給的多樣性，為行業參與者提供了更多元的選擇，推動PCB及半導體等行業的發展。
- 持續提升中國國產等離子及半導體技術知識產權自主可控。我們的等離子處理、半導體去膠及刻蝕等技術均由內部研發團隊獨立研發。我們亦在半導體薄膜沉積等其他領域投入研究。我們的產品尤其是半導體產品可有效支持中國在半導體刻蝕等領域技術的自主研發。

我們的亮眼經營及財務表現

受益於中國及全球PCB、消費電子及半導體相關產業近年來的迅速發展，我們的產品出貨量保持高速增長。於往績記錄期間，我們用於PCB製造及其他應用的等離子除膠渣設備出貨量從2023年的77台增長至2025年的121台。我們於2023年、2024年及2025年的用於半導體製造的設備出貨量分別達32台、126台及48台。

優秀的經營表現支撐我們的亮眼財務指標。我們的收入從2023年的人民幣138.5百萬元增加至2025年的人民幣176.0百萬元，複合年增長率達12.7%。我們於2023年、2024年及2025年的毛利率分別為53.3%、50.0%及56.0%，體現我們產品強大的市場競爭力；我們於同期實現淨利率分別為26.6%、26.2%及21.2%。

我們的競爭優勢

我們認為，以下競爭優勢鑄就了我們的成功，使我們從競爭對手中脫穎而出並贏得信賴：

我們是領先的等離子處理設備製造商，並在中國先進半導體處理設備領域快速發展

我們是中國領先的等離子除膠渣設備製造商。我們多年來在研發和創新方面的投資已見成效，在等離子處理設備領域形成自主知識產權，並在國內保持領先。我們自主研發的等離子處理技術已成功應用在PCB及其他高科技電子製造的除膠渣工藝中，且我們的產品被頭部下游客戶廣泛應用。

業 務

受益於我們在等離子技術方面的深厚積累，我們已自主孵化半導體刻蝕技術並實現了商業化，我們的目標是發展成為中國擁有半導體刻蝕技術自主知識產權的先進半導體加工設備製造商。於推出先進半導體處理設備、干法去膠設備及干法刻蝕設備以來發展迅速。於2025年我們實現半導體製造設備銷售收入人民幣19.2百萬元，佔同年總收入比例達10.9%。我們在光刻膠固化、微波等離子刻蝕及晶圓支撐架構等半導體技術領域擁有專利，從而突破國外製造商的壟斷。此外，我們深知半導體產業鏈的完整對中國半導體行業整體發展的重要性，並致力於以半導體製造設備價值鏈為基礎，推動各環節國產化。我們不僅專注用於半導體製造的處理設備的整體研發，亦關注原材料的自主可控。於2025年，我們半導體製造產品中超過90%的原材料及零部件來自國內供應商，反映了相對較高的國產化比例。

我們的設備製造能力，可提供定製化且高性價比的進口設備替代方案，通過國產化解決方案搶佔市場份額的同時，亦能增強供應鏈安全性，以抵禦全球經濟環境中的不確定性。我們在等離子及半導體製造設備領域屢獲殊榮，取得中國及海外機構頒發的多項資質證書。此外，我們被評為「國家級專精特新小巨人企業」及「國家高新技術企業」，並且是廣東省唯一的低溫等離子體工程技術研究中心，持續為半導體製造設備的自主可控進程添磚加瓦。

關鍵技術領先，確保產品持續滿足客戶需求並在行業中普遍應用

等離子及半導體行業是高度技術密集型行業。我們注重對研發的投入，致力通過技術領先以持續保持我們的產品性能領先。

依託超過30年的研發積累，我們在等離子技術領域實力領先。截至最後實際可行日期，我們已獲得27項已批准專利，在等離子密度、等離子處理設備均勻性等方面有著優良表現。我們是行業內首批推出上下料設備的公司之一，能在大幅提升生產效率的同時維持產品的高良率與一致性。此外，我們改進的遠端等離子源能在最大程度上減少等離子體造成的損傷，實現高效的光刻膠剝離率，為下游客戶提供卓越的晶圓處理方案。我們的等離子工藝設備不僅可用於大批量除膠，亦可通過使用多種化學物質來改進高劑量離子注入光刻膠去除工藝，可廣泛應用於氮化硅、氧化物，及金屬層等多種材料工藝。

我們的技術領先亦來自於我們對客戶前沿需求的精準把握。有別於其他競爭對手，我們致力為客戶提供滿足其特定需求的定製產品，以彌補市面上產品在功能、精細度以及適配性等方面的不足。我們在項目需求調研階段便會安排我們的研發人員參與和客戶的交流，深入了解客戶所面臨的痛點及訴求。此外，我們亦會自發地對交付產品進行調試、優化，

業 務

並根據客戶使用產品過程中的回饋持續改進產品缺陷，以實現產品功能的更新迭代。根據客戶需要，我們亦會與部分客戶進行聯合研發，以提供更為契合的高度定製化產品。在半導體及PCB等行業快速發展及產品迭代的當下，該等差異化的策略使我們能持續跟蹤客戶需求的演變，包括下游產品升級對生產工藝的需求變化、生產流程優化及產品品質標準提升。

得益於對行業前沿需求的洞察與契合，我們的定製化產品除了滿足目標客戶不斷增長的需求，亦能在有限調整的情況下被行業內廣大客戶群體逐步採用，這使得我們有別於同樣提供定製產品的一般設備定製公司。我們的定製產品通常具有足夠的複購力，既來自於目標客戶的擴大生產需求，亦包括其他潛在客戶的採購。我們的產品往往具有更長的銷售生命週期，並能有效攤薄我們的前期定製研發投入成本，同時使我們具備強大的供應鏈管理能力，並在後續產品銷售中保持穩定的高毛利水準。於2023年、2024年及2025年，我們的毛利率分別為53.3%、50.0%及56.0%，始終保持在較高水準，並在同業頭部公司中保持領先地位。

持續擴展且性能強大的產品組合

我們一直致力於提供多元的產品組合，以快速應對客戶需求的持續演變。截至2025年12月31日，我們依託豐富的項目開發經驗及對行業未來發展方向的前瞻性判斷，形成了多種核心設備。我們的產品組合具有以下優勢：

- **功能覆蓋多樣：**我們的產品可實現等離子干法去膠及刻蝕、PCB材料表面清潔、PCB材料活化處理、等離子鍍膜、等離子滅菌等多種功能，並可在同一台設備中實現不同材料、不同工序的複合處理，可滿足客戶不同應用場景及生產需求。

特別是在半導體干法刻蝕設備領域，我們的干法刻蝕設備已覆蓋電容耦合等離子體刻蝕（「CCP」）技術，並計劃推出兼具金屬刻蝕與多晶硅刻蝕技術的干法刻蝕設備，從而成為國內少數能夠同時主營CCP以及金屬與多晶硅干法刻蝕設備的廠商之一。

- **應用領域寬廣：**依託我們技術的可擴展性，我們的產品目前主要應用於集成電路、功率半導體、化合物半導體、PCB等材料等領域，並用於科學研究，商業化潛力強。我們亦持續探索包括新能源及前沿顯示等在內的其他領域應用機會，不斷拓展我們的產品業務邊界。

業 務

- **晶圓尺寸齊全：**我們的半導體干法刻蝕設備兼容4英吋、6英吋及8英吋晶圓，而我們的半導體干法去膠設備能容納4英吋、6英吋、8英吋及12英吋晶圓。我們用於半導體製造的設備覆蓋全譜系晶圓尺寸，可充分滿足不同客戶不同產品規格的生產加工需求。

我們的產品具有集成度高、性能優異等特點。尤其在生產性能方面，我們的產品生產速率快、產能高、均勻性好，能有效提升客戶生產效率。特別是我們的等離子處理系統的均勻性可達85%以上。

我們的產品根據客戶需求而開發，助力下游客戶在生產流程中各項指標達到卓越水平。例如，我們的5G Fermat等離子處理設備融合了市場領先技術的精華，可以處理幾乎所有主流PCB材料，均勻性要求可達90%，生產效率為普通垂直設備的2.5倍。在半導體製造設備領域，我們的干法刻蝕設備具備刻蝕速率高、均勻性好、易於維護及成本低的優勢。

差異化客戶觸達及穩定客戶合作關係

我們以用戶為中心開展我們的業務，致力於為客戶提供極致體驗。我們十分注重對於特色下游客戶的觸達，並通過定製產品及優異的產品品質，實現客戶覆蓋範圍的持續擴大及與各類客戶的長期合作。

根據弗若斯特沙利文的資料，2025年中國半導體刻蝕設備市場的國產化率僅為27.8%，處於較低水準，國際半導體製造設備廠商仍佔據優勢地位。同時，大量的專業半導體廠商意味著對其製造過程中使用的設備的不同需求，彼等對快速響應及成本效益的需求為我們的增長創造了巨大的機遇。隨著中國半導體行業的快速發展，我們預期該等市場的規模及多樣性有望迎來進一步爆發。

我們在多年的運營中打造了眾多標杆合作項目，我們的產品品質及服務口碑從行業大眾客戶向頭部客戶不斷擴展。目前，我們已與多家消費電子龍頭企業達成合作。在半導體領域，我們已獲得來自福聯集成、長電科技、中國中車的穩定訂單，並持續爭取包括第三代半導體材料企業在內的其他頭部客戶的業務機會。我們的分階段客戶開發策略已見成效並持續從中獲益。

於2023年、2024年及2025年，我們服務的客戶數量分別為134名、137名及150名，遍佈PCB、半導體、消費電子及其他行業等高科技電子領域。我們依託我們的產品口碑贏得我們客戶的長期信賴。我們與58名客戶合作超過5年，部分客戶合作時間更是超過10年，體現客戶對我們產品和服務的持續認可。

業 務

戰略性佈局海外市場，賦能中國品牌走向世界

我們戰略性佈局海外市場。我們的關鍵技術與卓越服務口碑贏得海外客戶認可，實現了用於半導體製造的等離子處理設備的國產品牌發展的里程碑。

我們採取戰略性全球市場拓展路徑，並憑藉我們領先的核心技術及優良的服務口碑贏得海外客戶信賴，實現國產半導體製造設備品牌走向世界的里程碑式發展。

早在2008年，我們便已在北美洲、歐洲等地設立服務網點，戰略性開拓海外業務，是中國同類廠商出海的先行者。我們在海外以「寶豐堂」品牌經營我們的業務，並拿下美國多家主要PCB廠商的訂單，成功在海外站穩腳跟並穩步發展。截至2025年12月31日，我們的產品已銷往11個國家及地區，主要包含中國內地、東南亞、北美洲及歐洲等，為全球領先電子產品廠商提供服務。

我們的專業能力在全球範圍內均得到認證。我們在歐洲、東南亞等多個國家和地區直接或通過與當地服務提供商合作提供產品及一體化服務，實現了對當地客戶的有效觸達及對其需求的高效響應。我們成功解決了中國企業出海過程中常常面臨的「最後一公里」服務難題，為客戶提供長期穩定的售後支持服務，並以此獲得來自海外客戶的肯定與長期合作。

得益於我們的卓越產品品質及精細服務保障，我們在全球範圍內建立了廣泛的客戶基礎，海外收入貢獻持續增長。於2023年、2024年及2025年，我們來自於海外客戶的收入佔比分別為30.8%、24.9%及41.5%，遙遙領先於中國同行業的其他頭部公司。

富有遠見並具開拓精神的管理及人才團隊

我們的創始人趙芝強先生是中國等離子設備行業的先行者，在半導體相關行業有超過30年的專業知識，曾就職於領先的快捷半導體產品有限公司。趙芝強先生見證並伴隨了中國半導體製造設備領域的國產化發展浪潮，對行業有著深厚的洞察及獨到的理解，帶領我們持續走在行業前沿。

我們的管理層團隊由複合背景的資深專業人士構成，平均具備超15年的等離子工藝及半導體製造設備、投資銀行及企業管理的從業經驗，使我們在持續迭代產品技術的同時保持敏銳警覺，並具備提前佈局及快速回應行業變化趨勢的能力。

業 務

我們深知專業人才對我們發展的重要性，將專業人才視為維持及鞏固我們競爭優勢並實現我們價值主張的關鍵成功因素。我們的研發團隊專家擁有等離子及半導體製造設備國際領軍製造商的從業經驗，使我們的研發能始終對標國際一線水準。截至2025年12月31日，我們研發人員佔總僱員數量超20.6%，其中49.3%以上擁有超過五年的工作經驗。

我們的發展戰略

我們致力通過實施以下戰略，以期實現我們的業務目標及使命：

加強半導體製造行業的業務佈局

我們相信，中國乃至全球半導體市場擁有廣闊市場空間。為此，我們將持續投資於用於半導體領域的等離子處理設備的業務增長，以期在半導體製造行業快速發展的浪潮中貢獻我們的力量，並從中獲益。

我們的等離子技術已在半導體製造領域成功應用。我們擬進一步加強我們在半導體製造領域的相關技術儲備，不斷強化刻蝕技術，包括在金屬刻蝕、多晶硅刻蝕等方向的技術研發。此外，我們亦打算向薄膜沉積及先進封裝等方向拓展，不斷提升我們在提供用於半導體製造的等離子處理設備方面的競爭力。

我們亦計劃豐富我們半導體製造設備的產品組合。我們擬將我們的半導體刻蝕產品擴展至金屬刻蝕及多晶硅刻蝕設備，應用場景亦從介質刻蝕向硅刻蝕、金屬刻蝕等領域延伸。我們認為以全面對標其他頭部半導體製造設備廠商，使我們在半導體領域保持十足競爭力。我們亦計劃研發並推出金屬刻蝕、多晶硅刻蝕等新型功能設備，以更全面地滿足客戶多樣需求。我們相信，多元的產品組合、優異的產品性能和差異化的客戶觸達策略將有助於確保並鞏固我們在中國用於半導體製造的等離子處理設備市場的重要地位。

我們還打算強化我們在半導體製造設備自主知識財產權方面的儲備，加強對核心零部件的研發投入，不斷完善我們在半導體製造設備供應鏈的佈局，逐步實現我們在半導體製造設備生產環節的自主可控，並豐富我們的產品矩陣。

業 務

持續投資技術創新

我們致力於以技術創新為核心驅動力，不斷保持我們的競爭優勢。我們期望鞏固多年積累的等離子加工技術，持續攻堅先進技術並探索其在不同領域的商業化落地機會。

我們將持續加大研發投入，為各項技術創新與產品升級提供堅實的財務保障。我們擬廣納賢才，積極從科研院所、同業公司中招募具實力及發展潛力的研發人員、工程師乃至技術專家，充實研發團隊力量，打造一支具備多元知識結構和豐富實踐經驗的創新主力軍。我們計劃購入先進測試儀器以及專業工具，滿足從基礎理論研究到產品開發等各個環節的高精度、高效率需求。我們亦注重產學研合作，計劃與國內外多所知名高校和科研機構建立緊密的合作關係，共同驅動技術的革新與研究成果的有效轉化。

不斷拓展產品組合並提升產品性能

豐富多元且性能優異的產品組合是我們與其他競爭對手形成差異並贏得客戶的關鍵因素。為此，我們將不懈地致力於拓展並深化我們的產品矩陣，並推動產品性能的持續進階。

我們計劃一如既往地根據市場變化不斷推出新產品，以緊密貼合下游客戶的產品迭代週期以及多樣化的需求。此外，我們計劃進一步延展至更為廣泛的應用領域，實現多元化佈局。未來，我們亦擬進一步向新能源、前沿顯示及精準醫療等領域開拓市場。

我們亦會持續聚焦產品性能提升。我們將不斷提升我們產品的功能豐富度、性能指標及品質，加強產品專業化、智能化、產品可及度及使用便捷性，不斷優化及雕琢並打造具競爭力的護城產品，增強市場吸引力和客戶粘性。具體來說，我們擬進一步加強PCB產品的深耕細作，著力強化佈線密度、信號傳輸穩定性等性能，全方位提升性能表現與品質優勢。在開發用於半導體製造領域的等離子處理設備方面，我們將持續探索和改進干法去膠設備及干法刻蝕設備等產品，並緊跟行業前沿優化工藝，努力提高半導體製造產品的應用性能。

進一步開發我們的產能及生產工藝

強大且穩定的產能支持是我們快速響應客戶需求的關鍵，更是構成我們核心競爭優勢的重要基石。為了更加從容地應對產品潛在市場需求的波動與增長，我們計劃審慎地擴大產能。具體而言，我們計劃在位於珠海的新總部建設生產基地，結合我們未來的市場及需

業 務

求預期，引入先進的生產設備、優化生產線佈局以及完善配套設施。於完成新增生產基地的建設後，我們預計我們的年度計劃產能將在未來實現顯著增長，至2027年目標達到具備年產300台等離子處理設備的能力。

我們亦打算不斷進行生產工藝改進，引入智能製造技術、精益生產方法論以及數字化管理理念，對生產流程進行優化與再造。我們致力於實現產能利用率的最大化提升和生產效率的飛躍，從而在保障產品品質的前提下，以更低成本、更高效率為客戶提供優質的產品和服務。

加強對半導體領域海外銷售業務機會的探索，實現全球擴張

國際市場對我們而言至關重要。我們秉持著積極進取的姿態全力開拓國際市場疆域，尤其是向全球半導體製造業銷售我們的等離子處理設備，依託我們在中國境內的成熟運營經驗以及海外業務的成功案例，擬戰略性地將我們的海外業務進一步發展。

我們打算在現有海外市場佈局的基礎上，進一步拓展東南亞市場，把握該等地區的業務機會。為此，我們擬在當地設立銷售服務團隊及售後支持團隊，以提供屬地化支持服務，使我們能快速扎根當地市場。

我們相信，符合當地客戶需求的產品更容易打入當地市場。我們打算在海外市場因地制宜地開發更符合海外客戶需求的產品，在精細化、易用性及本地化適用等方面持續提升，形成產品優勢，並以此不斷爭取海外客戶訂單，穩步驅動我們業務在全球範圍內的擴張。

尋求戰略投資及收購機會

我們將有選擇地推動我們認為可以提升我們核心競爭力及擴大市場覆蓋的投資及收購機會。

我們持續關注市場中與我們業務發展契合的優秀團隊或企業，傾向尋求在真空泵、機械手、射頻電源、海外銷售渠道等方面能對我們形成補充或增強，並在戰略上對我們的長期目標有利的團隊或公司作為我們的戰略合作夥伴或投資及併購潛在標的，以期將其優勢能力與我們進行整合，提升我們的綜合實力。我們將基於諸多因素評估該等收購，包括是否符合我們的戰略規劃、技術專長、是否能有效發揮協同效應、管理團隊之經驗、標的估值、過往經營表現等。我們的管理層會認真評估可能不時出現的此類機遇。

截至最後實際可行日期，我們尚未確定任何潛在的投資或收購目標，亦未訂立任何明確的投資或收購協定。

業 務

我們的產品及服務

我們是在中國享有重要市場地位的等離子處理設備製造商，專業從事等離子處理設備的研發、生產製造與銷售。作為中國專業的等離子處理設備製造商，我們為PCB及半導體製造等高科技電子領域的客戶提供全面的等離子處理設備。此外，我們還提供與等離子處理設備相關的各種零部件及配件以及維修及維護服務，以滿足客戶的多樣化需求。

等離子是由離子和自由電子組成的電離氣體的一種狀態，有著獨特的物理和化學性質。有關性質使等離子能有效與各種材料相互作用，成為表面處理應用中的一種有價值的工具。利用可生成氣體混合物、壓力和功率等參數的高精度設備，精確指定和調整等離子與表面材料相互作用的影響，實現預期的成果。因此，待處理的材料將被衝擊，並與混合氣體一併排出。在等離子的化學反應過程中，電離粒子會與被處理物體表面反應形成新的化合物，然後與其他氣體一起排出。常見的等離子處理包括等離子刻蝕、表面活化以及塗層，其廣泛應用於各種工業領域。

憑藉我們在等離子處理技術方面的專業能力，我們提供用於PCB及半導體製造以及消費電子等其他應用領域的多樣化且先進的等離子處理設備組合，以滿足下游客戶對高端處理環節的高技術、高效率需求。我們的資深技術人員在深入了解客戶對處理環節設備的需求後，基於傳統處理技術和設備進行改良，並精心設計和研發高性能的處理設備。我們的生產基地既能生產滿足客戶非標準化需求的定製設備，也能製造標準化的先進工藝設備，例如干法去膠設備及干法刻蝕設備，以滿足下游客戶的大量採購需求。此外，我們可根據客戶需求提供設備維修及維護服務。除了就所售產品在保修期內提供安裝、定期檢查及維護服務外，我們還為保修期屆滿後的產品提供收費的維修和維護服務。鑒於我們的技術和生產能力，應客戶要求，我們還被客戶聘請為其從同行企業購買的應用於PCB產品的等離子處理設備提供維修和維護服務。我們在等離子處理設備方面的廣泛產品覆蓋，加上我們提供靈活服務的能力，產生了一種協同效應，進而增強了我們在行業生態系統中的影響力。下圖展示了我們為客戶提供產品和服務的流程，涵蓋了客戶對先進等離子處理設備的全生命週期需求。

業 務



於往績記錄期間，我們的收入主要來自(i)銷售應用於PCB製造及其他行業的等離子處理設備，主要包括等離子除膠渣設備，以及用於PCB製造的輔助設備；(ii)銷售應用於半導體製造的等離子處理設備，主要包括干法去膠設備及干法刻蝕設備，以及用於半導體封裝的其他等離子處理設備；(iii)用於等離子除膠渣設備的上下料設備；(iv)銷售用於等離子處理設備的零部件及配件；及(v)提供等離子處理設備的維修及維護服務。下表載列於所示年度我們按業務分部劃分的收入明細：

	截至12月31日止年度					
	2023年		2024年		2025年	
	人民幣千元	%	人民幣千元	%	人民幣千元	%
設備						
用於PCB製造及其他應用領域	86,825	62.7	79,058	52.8	103,819	59.0
—用於PCB製造的等離子除膠渣設備	76,712	55.4	59,534	39.8	76,637	43.5
—用於其他應用領域的等離子除膠渣設備 ⁽¹⁾	10,113	7.3	19,524	13.0	23,218	13.2
—用於PCB製造的輔助設備	—	—	—	—	3,964	2.3
用於半導體製造	11,779	8.5	35,569	23.8	19,232	11.0
—用於半導體封裝的設備	11,779	8.5	18,851	12.6	15,777	9.0
—干法去膠設備及干法刻蝕設備 ..	—	—	16,718	11.2	3,455	2.0
用於等離子除膠渣設備的上下料設備	16,424	11.8	2,890	1.9	7,082	4.0
小計	115,028	83.0	117,517	78.5	130,133	74.0
零部件及配件	13,290	9.6	20,290	13.6	28,794	16.3
維修及維護服務	10,213	7.4	11,903	7.9	17,114	9.7
總計	138,531	100.0	149,710	100.0	176,041	100.0

業 務

附註：

(1) 主要包括消費電子、汽車電子及顯示面板電子元件。

於往績記錄期間，我們致力於PCB及其他高科技電子領域應用的設備研發，並開發了一系列全面的等離子處理系統，旨在增強表面處理工藝(如清洗及活化)，該等工藝對提高PCB的性能及可靠性至關重要。我們亦已從事半導體除浮渣設備、整平設備及撕膜設備等半導體封裝設備製造的研發。認識到半導體製造中高精度處理設備不斷增長的需求，自2023年3月起，我們將我們提供的產品擴展至干法去膠設備及干法刻蝕設備。該等產品憑藉我們在等離子技術方面30多年的專業知識，可滿足先進半導體製造工藝的嚴格要求。

下圖說明我們按應用領域分類提供的不同類型產品。

用於PCB製造及其他應用領域的設備



5G-FERMAT等離子除膠渣設備



卷對卷等離子除膠渣設備

用於半導體製造的設備



SDU-2000
(干法去膠設備)



SEC-200
(干法刻蝕設備)

業 務



M23S (等離子除浮渣設備) M03Q (等離子除浮渣設備) JET-AP05 (等離子除浮渣設備)

用於等離子除膠渣設備的上下料設備



上下料設備

用於PCB製造及其他應用領域的等離子除膠渣設備

PCB製造及消費電子等其他應用領域對等離子除膠渣設備的市場需求持續穩定且規模可觀。憑借在這些市場的長期深耕，我們已確立領先市場地位。根據弗若斯特沙利文的資料，按2023年至2025年各年於中國產生的收入計，我們在中國PCB等離子除膠渣設備市場排名前三。我們針對PCB及消費電子行業設計的產品涵蓋一系列等離子處理系統，主要用於PCB及消費電子生產製造與產後維護過程中的清潔及其他必要工序，能有效去除表面的污染物與氧化層，提升錫焊焊接和壓焊性能。

用於PCB製造的等離子除膠渣設備



我們開發了多種等離子清潔設備，能夠處理不同的印刷電路板，包括活化和清潔工藝。印刷電路板材料活化有助於保持良好的表面潤濕性。適當的潤濕對於印刷電路板材料來說非常重要，可確保在塗覆、壓焊、印刷或錫焊焊接過程中的有效粘附性。

油和油脂等污染物會阻礙潤濕性，即便許多材料的表面經過清潔，也可能無法與液體、粘合劑或塗層形成足夠的潤濕性。傳統方法通常採用化學底漆和粘附性促進劑進行活化，這類物質因呈強酸性或強鹼性而往往具有高腐蝕性，不僅會對材料及設備造成嚴重損壞，還會對操作人員構成安全風險，並產生環境危害。在進一步加工前，這類化學試劑需經過充分通風處理，且其活化效果無法長期維持。此外，化學底漆對聚烯烴等非極性材料的活化效果不佳。相比之下，我們的等離子活化技術處理速度更快、可靠性更高、環保性更強，無需使用額外化學品，且可對金屬、玻璃、陶瓷、天然石材及皮革等多種材料進行活化。

業 務

等離子除膠渣設備廣泛應用於高精度多層PCB的製造。隨著人工智能算力基礎設施(如AI服務器)等下游應用推動對更高層及更高密度PCB的需求，基於等離子的干法處理技術在PCB製造中持續發揮關鍵作用。

下圖載列截至最後實際可行日期我們用於PCB製造的主要等離子除膠渣設備的特性及應用資料：

產品名稱	圖片	特徵	應用	價格範圍
5G Fermat等離子除膠渣設備		<ul style="list-style-type: none"> 上升溫度極快 大產能生產 防止氟化物沉積的腔體絕緣設計 合理的等離子反應空間、處理更均勻 集成控制系統設計、操作更方便 	<ul style="list-style-type: none"> PTFE材料的活化處理 雙馬來酰亞胺三聚(「BT」)材料的加工 環氧樹脂的處理 聚酰亞胺的表面粗糙化與清潔 熱固性氰酸酯樹脂的活化與清潔 熱固性聚苯醚樹脂的活化與清洗 	<ul style="list-style-type: none"> 每台約人民幣1.0百萬元至人民幣2.1百萬元
卷對卷等離子除膠渣系統		<ul style="list-style-type: none"> 漸進式偏轉控制，確保收卷精度 恆張力、恆速控制 分離等離子反應區，確保等離子不影響其他機體 專利等離子處理設備 偏轉控制收卷體專利設計 	<ul style="list-style-type: none"> FPC的孔內鑽污去除和表面清潔 軋制聚酰亞胺的表面粗糙化與清潔 軋制覆蓋膜的表面粗糙化與清潔，一種用於封裝或覆蓋FPC暴露層的特殊材料 軋制電子材料的表面清潔 其他軋制材料的表面清潔 	<ul style="list-style-type: none"> 每台約人民幣2.1百萬元至人民幣5.7百萬元

於2023年、2024年及2025年，我們來自用於PCB製造的等離子除膠渣設備的收入分別為人民幣76.7百萬元、人民幣59.5百萬元及人民幣76.6百萬元，佔同年總收入的55.4%、39.8%及43.5%。


業 務

用於其他應用領域的等離子除膠渣設備

我們亦已戰略性地將產品佈局拓展至高附加值領域，為消費電子、顯示面板製造及其他行業的應用場景提供各類等離子除膠渣設備。

在消費電子行業，我們的半導體級精密除膠渣設備(包括芯片封裝等離子開蓋機及引線框架清潔系統)解決了焊盤氧化導致的焊接不良及環氧樹脂溢出污染金線鍵合區域等問題。我們的系統提供納米級精度，可在不損壞焊盤的情況下去除亞微米級污染物，採用可控的H₂/N₂混合氣體氣氛減少氧化物並提高焊點良率，並與SMT產線自動化集成，實現聯線生產。隨著先進封裝(2.5D/3DTSV)及碳化硅模塊鍵合工藝的需求不斷增長，該等產品已在移動SoC芯片的BGA焊盤清潔及功率模塊的銅基板活化等應用中進行了基準測試。

下圖載列截至最後實際可行日期我們用於其他應用領域的主要等離子除膠渣設備的特性及應用資料：

產品名稱	特徵	應用	價格範圍
 Prosumer-Virgo	<ul style="list-style-type: none">射頻功率驅動等離子體放電兼容在線製造工序，提升速度並實現最優效率低溫等離子避免熱變形經濟高效的設計，實現預算友好型環保等離子處理，無二次污染	<ul style="list-style-type: none">表面處理的製造工藝觸摸屏預處理鍵合/標記(B/M)印刷預處理防眩光/防指紋(AF/AG)塗層前的表面處理	<ul style="list-style-type: none">每台約人民幣0.2百萬元至人民幣1.3百萬元

用於PCB製造的輔助設備

我們還提供用於PCB製造從初始表面準備到最終檢測過程的輔助設備，包括膠帶應用設備、電鍍機、全自動雙流體清洗設備、金絲及晶圓檢測設備、在線烘箱及剝膜電鍍機。該等輔助設備乃向第三方供應商採購，並僅偶爾提供予我們的客戶，佔我們收入的比例相對較小。

用於半導體製造的設備

我們參與用於半導體製造設備的研發及製造。我們憑藉等離子技術的專業知識，製造並提供用於半導體封裝的等離子處理設備，包括半導體除浮渣設備、整平設備及撕膜設備。

業 務

微波等離子技術可有效降低材料表面的電荷效應，從而避免封裝過程中的表面碰撞問題，提升產品平整度。

憑借多年紮實的半導體技術專業知識，我們亦成功開發出半導體製造中用於刻蝕及光刻膠去膠工藝的高性能設備，以滿足先進半導體處理的嚴格要求。刻蝕涉及通過化學反應選擇性地去除沉積的材料層的特定部分，例如半導體晶片、印刷電路板、塑料和玻璃，在定義半導體設備的電性能中起著至關重要的作用。材料在刻蝕後表面積會增加，使得更容易潤濕。刻蝕後材料增加的表面積及增強的潤濕性有利於在後續工藝中進行更有效的粘附及壓焊。刻蝕效果通常用作印刷、膠合、塗裝前的預處理以及使材料粗糙化。另一方面，光刻去膠是去除刻蝕過程中使用的光刻膠材料的過程，對於防止殘留光刻膠影響半導體製造的後續階段而言至關重要。憑借我們專有的等離子體源技術及高刻蝕速率，我們的干法去膠設備及干法刻蝕設備表現出強勁的增長潛力，尤其是在半導體行業持續擴張方面。


干法去膠設備

我們的干法去膠設備是高密度等離子干法光刻膠去除和刻蝕系統，主要用於半導體製造過程中4英吋、6英吋、8英吋或12英吋晶圓上的光刻膠剝離和去膠工藝，可用作光刻工藝、光刻膠殘膠去除工藝、離子注入工藝、刻蝕工藝和等離子表面處理工藝之後的干法光刻膠去除解決方案。

我們的干法去膠設備採用高功率等離子源系統，具有去膠速度快、均勻性好、等離子損傷較小以及缺陷率低等優點。與同行業同行相比，我們改進的遠程等離子源有著高效的光刻膠去膠速率，提供了優質的晶圓加工解決方案。例如，與我們在市場上的競爭對手相比，我們的SVU系列干法去膠設備通過額外的腔室將干法刻蝕設備速率和每小時晶圓（「**每小時晶圓**」）提高了40%，在其加熱器基座中有著顯著更快的冷卻速度、更好的均勻性控制，並最大限度地減少了晶圓表面的溫差，以防止晶圓和加熱器基座之間的完全接觸而破損。通過盡可能最大程度地盡量減少等離子誘導的損傷來實現穩定的光刻膠去除。有關設備採用雙室設計，生產率高、維護方便、性能穩定以及運營成本低。我們的干法去膠設備不僅可用於大量光刻膠去除，亦可用於改進各種化學品的高劑量離子注入光刻膠去除工藝。此外，去膠機可用於各種工藝，包括相關氮化硅、氧化物和金屬層等的工藝。我們提供定製的解決方案，以滿足客戶的不同工藝要求。

業 務

下圖載列截至最後實際可行日期有關我們主要的干法去膠設備的特性及應用資料：

產品名稱	特徵	應用	價格範圍
SDU-2000 	<ul style="list-style-type: none">晶圓表面因等離子造成的損害最小支持標準厚度晶圓和Taiko薄晶圓的光刻膠去除高去膠速率、高產能和更長的清洗間平均間隔時間Windows平台開發的軟件、用戶界面友好	<ul style="list-style-type: none">晶圓尺寸兼容性：支持4英吋、6英吋、8英吋晶圓合適的材料：光刻膠、聚酰亞胺適用領域：集成電路、功率半導體、化合物半導體	<ul style="list-style-type: none">每台約人民幣2.1百萬元至2.8百萬元


干法刻蝕設備

我們提供干法刻蝕設備，專為半導體製造過程中的4英吋、6英吋和8英吋晶圓而設計。與使用腐蝕性酸進行濕法刻蝕的傳統刻蝕工藝（可能導致刻蝕不均勻、側向刻蝕及晶圓表面損傷等問題）不同，我們的等離子刻蝕技術利用等離子工藝去除表面材料，通常稱為干法刻蝕。在此過程中，反應性氣體轉化為等離子，將待刻蝕的材料從固相轉化為氣相，然後通過真空泵提取氣態副產物，完成刻蝕過程。這種干法刻蝕技術允許在掩模的幫助下選擇性刻蝕特定區域或結構，從而精確控制刻蝕過程。

我們的CCP系列干法刻蝕設備提供高刻蝕速率和出色的均勻性，涵蓋前後端應用中的所有電介質刻蝕工藝。我們的CCP系列干法刻蝕設備具有(i)比率頻率發生器和緊密耦合的匹配網絡，以確保快速、一致的刻蝕；(ii)全域工藝氣體進口噴嘴，可均勻分佈氣體；及(iii)高泵送速率，並提供寬廣的工藝氣體壓力窗口。我們的干法刻蝕設備包括單腔及多腔設計，具有以下特點：易於維護、性能穩定、生產率高以及客戶擁有和維護成本低。

業 務

下圖載列截至最後實際可行日期我們主要的干法刻蝕設備的特性及應用場景：

產品名稱	特徵	應用	價格範圍
 SEC-200	<ul style="list-style-type: none">刻蝕速率高、均勻性好可擴展的多腔體設計、實現高生產能力基於Windows系統開發的軟件、用戶界面友好	<ul style="list-style-type: none">晶圓尺寸兼容性：支持6英寸、8英寸晶圓適用材料：二氧化硅、氮化硅、氧氮化硅、單晶硅以及多晶硅適用工藝：多晶硅；氮化硅；氧化物適用領域：集成電路、功率半導體、化合物半導體及科學研究等。	<ul style="list-style-type: none">每台約人民幣2.2百萬元至3.8百萬元(視乎腔數而定)

於2023年、2024年及2025年，我們來自干法去膠設備及干法刻蝕設備的收入分別為零、人民幣16.7百萬元及人民幣3.5百萬元，分別佔相應年度總收入的零、11.2%及2.0%。

用於半導體封裝的等離子除浮渣設備

我們提供一系列用於半導體封裝的設備，覆蓋各種封裝類型的生產工藝，如球柵陣列封裝、晶片級封裝、平面網格陣列封裝和針柵陣列封裝工藝，主要包括等離子除浮渣設備、整平設備及撕膜設備。


我們的等離子除浮渣設備設計為利用等離子技術，以激活並清潔材料表面。其為倒裝晶片元件填充前的清潔工藝設計。我們的等離子技術可降低材料表面的電荷效應，減少離子向材料表面的移動，並在去除氧化層及激活表面的過程中避免表面碰撞，從而提高材料的可靠性。

我們的整平設備為球柵陣列封裝工藝設計。該整平技術可對半導體基板上的焊料凸點頂部進行整平處理，形成平整的焊料凸點頂部表面並創造光滑的上表面。其可實現焊料凸點的精確且一致整平，確保半導體封裝的均勻性及可靠性。與傳統方法相比，傳統方法會導致凸點高度不均勻及不平整表面，從而導致不良的電氣連接及產品性能下降。通過實現光滑平整的表面，我們的凸點整平設備提升了半導體原件的整體質量及功能，使其成為現代半導體製造工藝中不可或缺的工具。

業 務

我們的撕膜設備旨在自動化且高精度地去除覆蓋在基板表面的保護膜，如藍膜或UV膜。傳統手動或簡易設備撕膜存在以下問題：1) 因人工操作導致基板刮傷、崩裂、殘膜或撕裂，良率較低；2) 手動操作速度慢，無法滿足量產需求，存在效率瓶頸；3) 人工接觸引入灰塵或油污，且撕膜過程中產生的靜電吸附顆粒，污染風險較高。我們的撕膜設備通過精密機械控制、高精度視覺定位及靜電消除系統，可實現高良率、高效率及高潔淨度。

下圖載列於最後實際可行日期我們的主要等離子除浮渣設備的特性及應用場景：

產品名稱	特徵	應用	價格範圍
M23S 	<ul style="list-style-type: none">• 高密度電漿，蝕刻均勻度高於90%• 伺服定位控制的自動上下料功能確保傳輸精度• 掃瞄式處理，確保低溫製程• 自動去除表面蝕刻殘留粉塵• 獨特氮氣冷卻技術，適用於對熱更敏感的材料處理	<ul style="list-style-type: none">• 實現半導體基板介電層的均勻蝕刻• 聚酰亞胺表面粗化與蝕刻• 聚合物材料表面活化• 晶圓灰化• 晶圓光阻去除	<ul style="list-style-type: none">• 每台約人民幣2.2百萬元至人民幣2.7百萬元

業 務

產品名稱	特徵	應用	價格範圍
M03Q 	<ul style="list-style-type: none"> 可編程邏輯控制器(PLC)進行程序控制，配備靈活的參數設置以及安全可靠的監控與保護功能 兩步式等離子處理工藝，蝕刻與清洗要求可按需定製 實時監控等離子處理時間及每個步驟的處理時間 標準配備兩個氣體通道，並可根據工藝需求增配 支持半導體設備通訊標準(SECS)/通用設備模型(GEM)的授權費 	<ul style="list-style-type: none"> 去除硅樹脂 鍵合、焊接及粘合前的預處理 金屬部件塗層前的預處理 光刻前的預處理 印刷前預處理 	<ul style="list-style-type: none"> 每台約人民幣0.2百萬元至人民幣0.7百萬元
JET-AP05 	<ul style="list-style-type: none"> 通過觸摸屏及可編程邏輯控制器(「可編程邏輯控制器」)控制，智能化程度高、穩定性好。 操作簡單易懂，使用培訓成本低。 近乎完美的一體化設計，結構緊湊，佔地面積超小，擴展性強，噴嘴軌跡可定製。 可連接的在線自動生產、節省勞動力、物料搬運和跟蹤成本。 內部氮氣裝置允許使用壓縮空氣作為等離子工藝氣體，從而降低了可持續性的運營成本。 	<ul style="list-style-type: none"> 清潔金屬焊盤 提高晶圓壓焊的粘附性 晶圓碰撞前去污 去除氟和其他鹵素污染物 去除金屬及金屬氧化物 提高旋塗膜的粘附 去除有機污染物 	<ul style="list-style-type: none"> 每台約人民幣0.1百萬元至人民幣0.4百萬元

於2023年、2024年及2025年，我們來自半導體封裝設備的收入分別為人民幣11.8百萬元、人民幣18.9百萬元及人民幣15.8百萬元，分別佔同年總收入的8.5%、12.6%及9.0%。

業 務

用於等離子除膠渣設備的上下料設備

上下料設備是一款專為等離子除膠渣設備設計的PCB板全自動上下料設備，可促進前後工序之間的工作流連接。作為等離子除膠渣設備應用場景中上下游生產工序間的智能樞紐，上下料設備具備高精度、高效率的PCB板自動化搬運能力。我們的上下料設備在配置上具備靈活性，最多可同時與四台等離子除膠渣設備協同工作。這大幅優化了多設備協同的生產效率，最大限度減少人工操作，並提高了操作效率。

下圖載列截至最後實際可行日期有關上下料設備的特性及應用資料：

產品名稱	圖片	特徵	應用	價格範圍
上下料設備		<ul style="list-style-type: none">• 專利高性能產品設計、人工成本較手動機型降低75%• 節能立式板材搬運系統、可兼容剛性和柔性板材• 提供多種裝載方式，包括水平、交錯紙張和傾斜支架選項• 兼容自動導引車（「自動導引車」）的全自動智能轉運系統• 支持MES、SECS、OPC-UA等各種製造通信系統	<ul style="list-style-type: none">• 用於等離子除膠渣設備的PCB板全自動上下料	<ul style="list-style-type: none">• 每台約人民幣1.4百萬元至人民幣3.0百萬元

於2023年、2024年及2025年，我們用於等離子除膠渣設備的上下料設備的收入分別為人民幣16.4百萬元、人民幣2.9百萬元及人民幣7.1百萬元，分別佔同年總收入的11.8%、1.9%及4.0%。

業 務

案例研究

場景1：干法去膠設備

我們根據客戶的要求開發了專門針對使用Taiko工藝的超薄晶圓(通常用於厚度小於100 μ m的高壓大功率裝置)的定製化干法去膠設備。該工藝可防止超薄核心區在製造過程中破損，從而提高器件成品率及長期可靠性。

- 應用領域：絕緣柵雙極型晶體管(「IGBT」)功率器件製造的後道工藝
- 我們的產品：SDU-2000
- 痛點：
 - 超薄IGBT晶圓嚴重脆性：IGBT晶圓的後道工藝(如背面減薄及金屬化)涉及高溫步驟，導致Taiko晶圓(尤其是超薄核心區)出現遠超標準晶圓的嚴重脆性。傳統設備在傳輸及夾持過程中極易造成破損。
 - 背面金屬層／器件結構的保護：IGBT晶圓的背面已經歷了關鍵的金屬化(如Al、Cu)或器件結構成型，是電性能的核心區域。傳統夾具在夾持時極有可能劃傷或污染背面金屬層，導致器件失效或可靠性降低。
 - 厚環結構的均勻去膠：需要確保具有顯著高度差(厚環vs超薄中心)的Taiko晶圓正面上的光刻膠(可用於金屬化後保護背面金屬圖案或用於後續工藝)能被均勻徹底地去除，而不會損壞下層器件結構或鈍化層。
- 研發重點：
 - 抗翹曲自適應傳輸系統：開發配備高精度變形傳感傳感器及柔性末端執行器的機械手。該系統可實時檢測並自適應匹配Taiko晶圓的翹曲形狀及高度差，實現無應力、平穩的晶圓拾取、放置及傳輸，徹底避免傳輸過程中的破損風險。
 - 背面零接觸卡環固定技術：工藝腔體的核心創新在於特殊設計的卡環。該卡環精確地將力施加到Taiko晶圓邊緣的厚環區域進行固定，完全避開了工件的超薄核心區及背面金屬層，從根本上消除了背面金屬劃傷及污染的風險。

業 務

- 與IGBT工藝兼容的去膠優化：優化工藝腔體內溫度場的均勻性及反應氣體／等離子體的分佈，以解決IGBT器件的材料特性帶來的挑戰及Taiko結構帶來的高度差。
- 成就：
 - 實現IGBT Taiko晶圓的安全去膠量產：該設備已成功集成到客戶的IGBT產線，穩定處理高度翹曲的超薄Taiko晶圓，支持客戶功率器件的後道製造。
 - 背面金屬層「零損傷」：獨特的卡環設計確保晶圓背面的關鍵金屬化區域在整個過程中保持無接觸，解決了IGBT製造中背面金屬保護的全行業挑戰，顯著提高了器件成品率及長期可靠性。
 - 高均勻性去膠確保成品率：優化的工藝確保了複雜Taiko結構正面的光刻膠被完美去除，且不會損壞正面器件，滿足IGBT嚴苛的電性能要求。
 - 賦能國產IGBT先進製造：該設備攻克了超薄IGBT晶圓處理的核心瓶頸，為國產IGBT產業鏈提供了高可靠、高性能的國產解決方案。

場景2：干法刻蝕設備

為了幫助我們的客戶提高等離子設備的使用效率和操作便利性，我們根據客戶需求開發了SEC-200，可提供自動化晶圓處理及裝載，從而增強整體工藝自動化程度並減少人工干預。

- 應用領域：微米至亞微米級硅集成電路製造；化合物半導體（如砷化鎵、磷化銦）的刻蝕；及微機電系統的製造
- 我們的產品：SEC-200
- 痛點：
 - 缺乏效率：傳統設備一般僅配置一個單工藝腔，且真空傳送系統採用皮帶機械手，導致晶圓搬運效率低，影響產線整體產能。
 - 擴展性不足：傳統設備無法擴展工藝腔，難以滿足多工藝並行需求。

業 務

- 維護成本高：傳統設備的關鍵部件依賴進口，配件更換週期短，導致維護成本高。
- 研發重點：
 - 模塊化真空搬運機械手：採用伺服控制的真空機械手，替代傳統皮帶式傳送。
 - 多腔體擴展架構：工藝腔體數量從1個擴展至3個，支持多工藝並行運行。
 - 長壽命設計降低維護成本：採用真空波紋管密封替代易損密封圈，關鍵耗材與Lam 4420通用，降低配件採購難度與成本。
- 成就：
 - 支持多晶硅、硅氮化物、氧化物等多種材料刻蝕，工藝切換時間縮短。
 - 設備採購成本低於進口同類產品。

銷量

下表載列於往績記錄期間我們主要產品的銷量詳情。

	截至12月31日止年度		
	2023年	2024年	2025年
用於半導體製造的設備			
— 半導體封裝設備	32	120	46
— 干法去膠設備及干法刻蝕設備	—	6	2
用於PCB製造及其他應用領域的設備			
— 用於PCB製造的等離子			
除膠渣設備	50	44	63
— 用於其他應用領域的等離子			
除膠渣設備	27	34	45
— 用於PCB製造的輔助設備	—	—	13
上下料設備	7	1	3

零部件及配件

於往績記錄期間，我們在生產基地進行生產，並向客戶銷售設備所用的零部件及配件，作為設備銷售的補充。我們生產及銷售的零部件及配件主要包括石英玻璃、真空泵、電機組件、中頻電源、柔性電路夾具、天線組件、微波匹配器及氧化鋁管。該等零部件及配件

業 務

通常用於更換設備運行過程中磨損或損壞的部件，從而有助於延長設備的使用壽命並保持穩定的性能。通過及時提供兼容的替換零件，我們不僅旨在提高設備的運行效率和可靠性，還通過全面的售後支持增強客戶忠誠度和滿意度。

維修及維護服務

於往績記錄期間，我們向客戶收取服務費以就超過保修期的產品提供維修及維護服務，且為認可我們的技術及生產能力，應客戶要求，我們亦獲客戶委聘為彼等從同行企業購買的等離子處理設備提供售後服務。該業務有效補充了我們的主要生產業務，原因是我們受惠於提高熟練僱員的利用率、拓寬了獲取最新技術需求和市場趨勢的渠道，以及擴大和深化與客戶的戰略合作的機會。

於2023年、2024年及2025年，我們的維修及維護服務收入分別為人民幣10.2百萬元、人民幣11.9百萬元及人民幣17.1百萬元。

研發

我們所有設備中使用的核心技術均由我們的內部研發團隊開發。我們已成功開發並推出多款以等離子處理技術為特色的設備，應用於PCB製造、半導體、消費電子等行業。我們還創新開發了全自動上下料設備，與等離子處理設備配合使用，以提高客戶生產過程中的運營效率。我們擬根據客戶需求及市場趨勢，通過加強新產品的研發及改進現有產品，擴大及改善我們的產品組合。

我們在產品及技術研發上投入大量資源。於2023年、2024年及2025年，我們的研發開支分別為人民幣10.1百萬元、人民幣10.5百萬元及人民幣12.0百萬元。我們在中國珠海建立的研發中心定位為領先的研發中心，致力於先進半導體干法工藝設備的研發，該中心專注於解決半導體製造核心領域的關鍵設備技術，深耕於利用等離子體物理、化學支持更先進工藝芯片生產的干法工藝。我們的售後和技術團隊與客戶建立了牢固的信任關係，使我們能夠快速識別市場趨勢及不斷變化的客戶需求。憑借客戶的反饋，我們的研發團隊利用其技術專長及深厚的行業知識，積極滿足客戶需求並推動持續創新和發展。我們在研發方面的努力取得了重大成就，創造知識產權和行業專業知識的歷史證明了這一點。截至2025年12月31日，我們在中國內地擁有27項已批准專利，包括16項發明專利和10項實用新型專利，以及一項外觀設計專利，在香港擁有兩項註冊商標以及在台灣擁有五項已批准專利，涵蓋光刻膠固化技術、常壓等離子鍍膜技術、PCB等離子清潔設備的結構技術等關鍵領域。有關更多詳情，請參閱本節「—知識產權」。

業 務

截至2025年12月31日，我們的管理層得到了由52名敬業僱員組成的強大研發團隊的支持，他們在機械設計、電氣工程、軟件工程以及設備安裝及調試方面擁有深厚的專業知識。我們高度重視研發人才儲備。截至2025年12月31日，研發團隊中超過34.9%的僱員擁有三年或以上的工作經驗，約超過25.6%的僱員擁有五年以上的工作經驗。

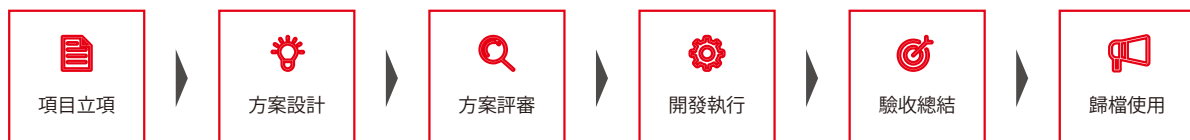
我們的核心技術

我們的核心技術等離子處理技術是一種乾燥、環保、高效的材料表面改性解決方案，其本質在於精確激發及控制工藝氣體，以產生含有離子、電子、自由基及其他活性物質的等離子體。這些活性顆粒通過物理轟擊及化學反應與材料表面相互作用，實現精密清洗、表面活化、精細刻蝕及納米級光刻膠去除。我們的技術專長建立在對等離子體物理及化學的深入理解之上，並得到以下三大核心技術支柱的支持：

- **等離子體高均勻性及深孔穿透能力。**通過創新射頻功率匹配技術及特殊設計的電極結構，我們可以在處理腔室內產生大面積、高密度及極其均勻的等離子體。
- **精確可控的反應選擇性。**我們的平台配備了多通道精密氣體輸送系統及智能工藝配方管理系統，可以精確控制氣體比例、流量、功率及壓力水平，從而微調等離子體中活性物質的成分及能量。
- **智能化可追溯的工藝控制。**通過將在線光學發射光譜監測與先進的終點檢測系統相結合，我們實現了實時過程控制及終點測定。

研發流程

我們通過下圖所示結構化研發流程進行產品開發：



我們的研發項目通過初步可行性分析後編製立項報告而建立。我們的研發團隊與銷售及售後支持團隊合作，就客戶對技術功能的需求以及對我們現有產品及技術解決方案的反饋汲取寶貴經驗，並開發概念性解決方案設計以供管理層審閱及批准。獲得批准後，我們的研發項目將被執行，並最終完成產品驗證。我們的研發成果將在項目完成前經過全面的內部檢查程序，匯總並編入我們的研發成果數據庫，然後在我們的生產過程中激活及使用。

業 務

知識產權

知識產權對我們業務的成功至關重要。我們的成功部分取決於我們獲得及維持與我們業務相關的重要商業技術、發明及專有技術的專利及其他知識產權及專有保護、捍衛及執行我們的專利、維護我們的商業機密的機密性以及在不侵犯、盜用或以其他方式侵犯第三方有效、可強制執行的知識產權的情況下運營的能力。

我們建立了全面的知識產權組合，以保護我們的技術和發明，並確保我們未來的成功。截至2025年12月31日，我們在中國內地擁有27項已批准專利，包括16項發明專利和10項實用新型專利，以及一項外觀設計專利，在台灣擁有五項已批准專利。截至2025年12月31日，我們在中國擁有八項註冊商標，在香港擁有三個註冊商標。有關詳情，請參閱「附錄六 — 法定及一般資料 — 知識產權」。

除作出商標及專利註冊申請外，我們亦實施一套全面措施，保護我們的知識產權。我們的主要措施包括：(i)專人指導、管理、監督及監察有關知識產權的日常工作；(ii)及時啟動知識產權的註冊、備案及申請程序；(iii)積極追蹤我們的知識產權狀況，並在發現與我們的知識產權存在任何潛在衝突時及時採取行動；及(iv)在我們訂立的所有僱傭合約及商業合約中訂明有關知識產權保護的相關權利與義務。

截至最後實際可行日期，我們並無因侵犯第三方商標、許可及其他知識產權而面臨任何重大糾紛或申索。

生產

我們內部開發了以商業規模生產產品所需的製造工藝。我們的製造團隊由我們的首席開發官徐元鋒領導，彼於等離子處理行業擁有約20年經驗。截至2025年12月31日，我們的生產部門有84名人員。我們向生產部門人員提供培訓，以確保彼等具備相關生產過程所需的技能及技術，並遵守我們的質量控制要求以及適用法律及法規。

我們的生產部門由三個專業部門組成：機械加工部、電氣控制部及裝配部。機械加工部將採購的材料加工成我們產品所需的零部件。電氣控制部根據我們的設計師提供的原理圖組裝控制面板。最後，裝配部將所有零部件及控制面板集成在一起，完成最終產品。

業 務

生產基地

憑藉我們豐富的行業經驗、先進的生產技術，我們建立了定製化的生產線，具有高度自動化程序、嚴格質量控制及ESG合規標準等特點。

於往績記錄期間，我們擁有一個生產基地，即珠海紅旗生產基地。下表載列截至2025年12月31日我們的生產基地詳情。

生產基地	位置	總樓面面積
珠海紅旗生產基地.....	廣東省珠海市	6,154.3平方米

僅就說明用途，下文載列我們珠海紅旗生產基地於所示年度的設計產能、實際生產產出量及使用率：

	截至12月31日止年度								
	2023年			2024年			2025年		
	實際生產			實際生產			實際生產		
	設計產能	產出量	使用率	設計產能	產出量	使用率	設計產能	產出量	使用率
	(小時)	(小時)	(%)	(小時)	(小時)	(%)	(小時)	(小時)	(%)
珠海紅旗生產基地.....	7,274	6,575	90.4	7,590	6,984	92.0	7,590	7,006	92.3

附註：

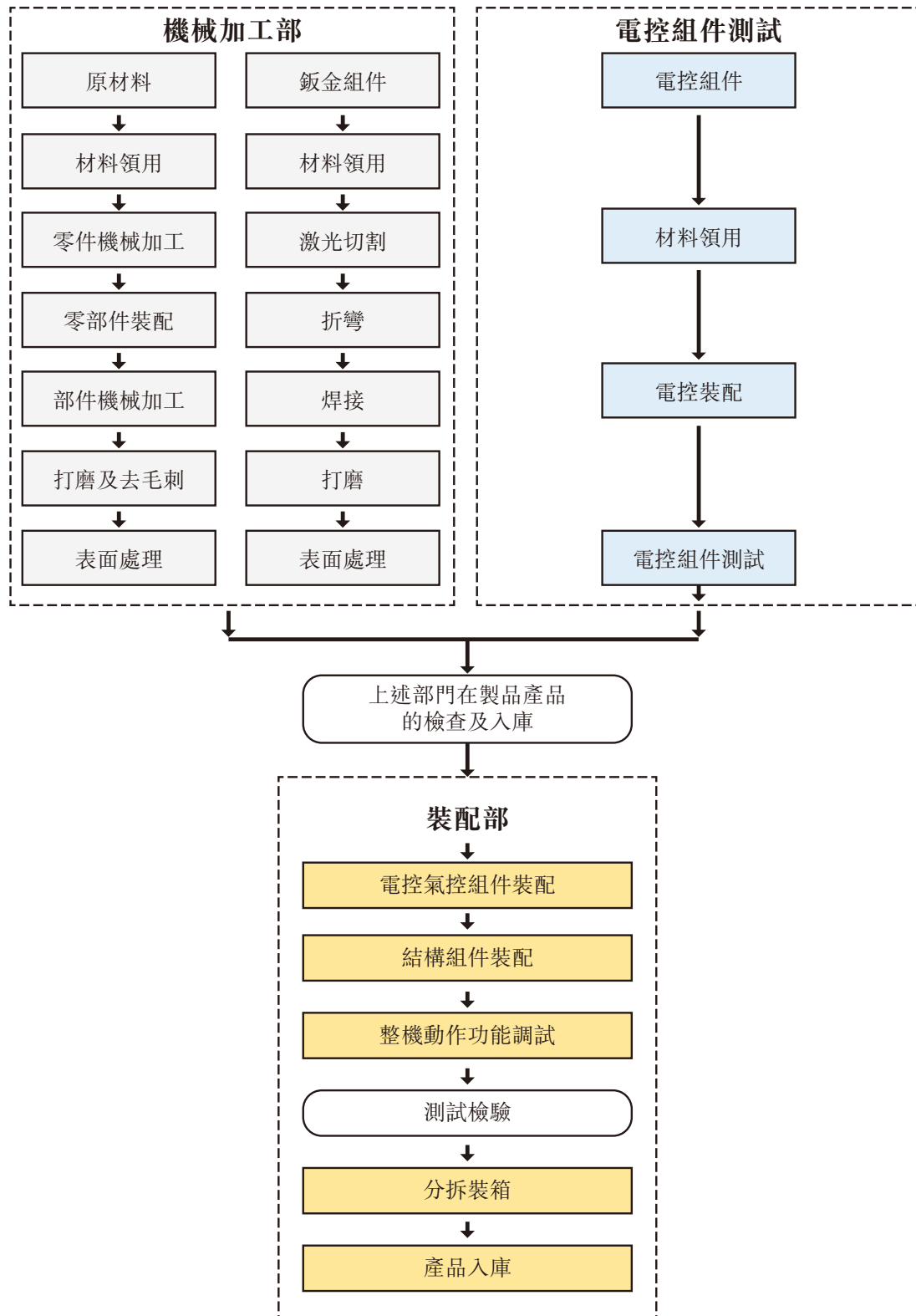
- (1) 各年的設計產能乃根據我們製造的各類設備所需的關鍵生產工序每年的運營天數及每天的標準運營持續時間計算。
- (2) 實際生產產出量指年內的實際生產時數。
- (3) 年內的使用率乃按實際生產產出量除以同年設計產能計算。

生產流程

我們採用全面的控制流程，確保我們製造的等離子處理設備符合先進半導體及PCB製造所需的最嚴格的純度及質量標準。

業 務

下圖載列我們的生產流程：



業 務

我們主要採用按訂單生產的生產模式，根據客戶的特定要求進行定製產品設計和製造。生產計劃乃根據客戶採購訂單制定和執行。主要生產流程涵蓋完整的價值鏈，從精密加工(包括深孔鑽削與攪拌摩擦焊)和鈹金製造到電子和結構部件的裝配、最終集成及嚴格測試。

生產流程的組織管理

生產流程通過集中生產計劃系統進行管理，並由三個專業部門進行：(i)機械加工部，(ii)電氣控制部，及(iii)裝配部。

關鍵生產階段

機械加工：機械加工部負責關鍵金屬部件的內部生產，包括電極板、腔室模塊和結構件。採用龍門銑床、摩擦焊接設備、數控精密機床等大型設備，按照嚴格的工程圖紙和技術規範對原材料進行加工。所有機械加工部件均需經過尺寸和表面光潔度的質量檢查後，方可入庫待用於總裝階段。

電氣控制組裝和測試：電氣控制部負責組裝和測試核心電氣部件，如電源單元。根據生產訂單，從倉庫中檢索包括電路板、高壓發生器和信號控制器在內的組件。我們的技術人員根據研發工程師提供的示意圖裝配該等部件，在進入生產及裝配線前進行嚴格的老化測試及質量檢查。

集成、最終測試和質量保證：裝配部負責執行等離子處理設備的裝配。該過程從腔室組裝開始，經過電氣與軟件工程師進行信號校準及機械動作調試的系統集成階段，最終進行最終測試，最終通過真空密封性、氣體流量及射頻發生器參數等系列測試，以確保符合裝運前的標準。

業 務

關鍵生產設備及技術

我們先進及高度自動化的製造設施對提高產品質量、成本競爭力及生產效率至關重要。我們設計、定製一套主流、先進的設備，並將其集成到我們的生產流程中。這種堅實的基礎設施確保了強大的交付能力和穩定的產品質量。我們的關鍵設備及其支持的專業技術包括：

攪拌摩擦焊(FSW)：我們配備了大型攪拌摩擦焊機械。這種固態連接技術利用非消耗性旋轉工具產生摩擦熱，使鋁工件塑化而不熔化。當工具穿過焊接線時，其會鍛造塑化材料以形成高強度、緻密的焊縫。這種先進的工藝使我們能夠在各種位置穩定地生產長尺寸、大截面的焊縫，具有卓越的完整性和最小的變形。

深鑽孔：我們的專用深孔鑽床可實現對具有高長徑比和複雜幾何形狀孔洞的精密加工。該工藝可在一次進給中完成卓越的尺寸精度、直線度和表面光潔度，確保零部件可靠性。

數控精密加工：計算機數控(數控)精密加工是一種高度自動化的製造過程，利用數控技術驅動數控機床按照預先設計的模型和相關軟件生成的指令對材料進行精密加工。我們的數控精密加工涵蓋數控攪拌摩擦焊機、數控加工中心和數控車床。這種全面的配置確保了我們所有核心部件都能獲得的高效和精確的製造。

維護

我們對生產設施及設備進行仔細及及時的維護，包括定期停機進行維護、維修及定期檢查設施及設備。這使我們能夠以最佳水準運行我們的生產線。我們對設備進行日常清潔及維護，以延長其使用壽命。我們亦按照行業慣例進行重大年度維護工作。我們全面的維護系統確保我們繼續保持運營效率及高質量控制標準。於往績記錄期間，我們的製造流程並無因設備或機械故障而出現任何重大或長期中斷。

銷售、營銷及客戶

銷售渠道及客戶

於往績記錄期間，我們擁有一支經驗豐富、訓練有素的銷售和營銷團隊，截至2025年12月31日，由48名人員組成，他們會主動識別市場機會並設計銷售策略。

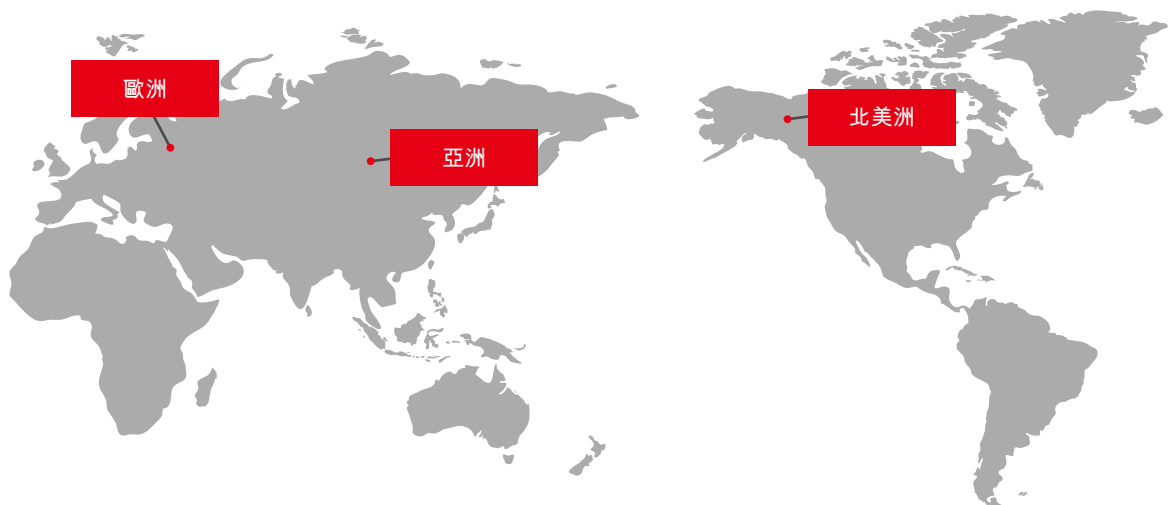
業 務

基於我們產品的強大競爭力及我們在等離子處理技術領域多年的專業知識，我們的產品銷往中國、東南亞、北美洲及歐洲。在中國，截至2025年12月31日，我們的產品銷往17個省、市、自治區及特別行政區。以下為截至2025年12月31日我們產品的國內市場及國際市場的說明：

國內市場



國際市場



業 務

於往績記錄期間，我們的產品於中國主要透過直銷銷售。為擴大我們產品的地區覆蓋、消費者範圍，我們在海外市場利用經銷網絡補充直銷。下表載列於所示年度我們按銷售渠道劃分的收入明細：

	截至12月31日止年度					
	2023年		2024年		2025年	
	金額	%	金額	%	金額	%
	(人民幣千元，不包括百分比)					
直銷.....	104,390	75.4	128,958	86.1	156,827	89.1%
經銷.....	34,141	24.6	20,752	13.9	19,214	10.9%
總計.....	<u>138,531</u>	<u>100.0</u>	<u>149,710</u>	<u>100.0</u>	<u>176,041</u>	<u>100.0%</u>

直銷

於2023年、2024年及2025年，直銷收入分別為人民幣104.4百萬元、人民幣129.0百萬元及人民幣156.8百萬元，分別佔同年總收入的75.4%、86.1%及89.1%。於2023年、2024年及2025年，我們分別擁有129名、132名及145名直銷客戶。採用直銷使我們能夠準確了解及回應客戶要求，使我們能夠提供滿足客戶特定需求的量身定製的產品及服務。我們主要通過利用我們透過與不同行業的頂級公司的長期、全面及深入合作建立的強大品牌聲譽及巨大的行業影響力獲得直銷客戶。

除採購訂單及一次性銷售協議外，我們還就直銷與客戶訂立框架銷售協議。框架銷售協議的主要條款包括：

主要條款	內容
持續時間	與直銷客戶訂立的框架銷售協議的持續時間由雙方協定，倘並無提前終止通知，則自動重續。
定價	我們按採購協議或採購訂單協定的價格向直銷客戶銷售產品。
付款及信用期限	我們一般於接受產品並收到有效且合格的發票後授予最多90日的信貸期。
物流	交付時間及方式通常由雙方於單獨的採購訂單中確定。
風險轉移	風險轉移及轉移後的剩餘賠償責任一般將由雙方於單獨的採購訂單中確定。
退貨安排	我們通常不允許我們的直銷客戶向我們退回產品，除非是出於有限的原因，如產品設計缺陷或質量問題。

業 務

終止 我們的直銷客戶通常有權根據各份採購訂單內釐定的期限提前發出書面通知終止協議。倘任何一方違反框架銷售協議且未能於收到書面通知後於雙方協定期限內補救違約情況，另一方有權終止本協議。此外，如果任何一方申請破產、受到第三方的破產申請或遇到其他約定的情況，另一方可以立即終止本協議。

經銷

於往績記錄期間，我們與境內外經銷商均存在經銷合作關係。該等經銷商為我們提供完善的經銷渠道、知名品牌、經驗豐富的銷售團隊及與目標客戶的長期聯繫。根據弗若斯特沙利文的資料，我們對經銷商的使用符合行業規範。於2023年、2024年及2025年，我們分別擁有五家、五家及五家經銷商。於2023年、2024年及2025年，來自經銷商的收入分別為人民幣34.1百萬元、人民幣20.8百萬元及人民幣19.2百萬元，分別佔同年總收入的24.6%、13.9%及10.9%。於往績記錄期間及直至最後實際可行日期，我們與經銷商並無重大未解決糾紛或訴訟。

我們與經銷商保持了買賣關係。他們直接向我們購買設備，並將該等設備轉售予終端用戶。我們認為，我們的經銷網絡渠道堵塞的風險微乎其微。我們並無對經銷商施加最低購買要求，除了有缺陷產品外，我們一般不允許退還銷售予經銷商的产品。根據弗若斯特沙利文的資料，我們與經銷商的退貨政策符合行業慣例。

我們根據多項標準選擇經銷商，包括彼等的經驗及資源、與下游製造商的關係、技術能力及財務狀況等。我們管理該等經銷商，並根據其表現釐定是否繼續與彼等維持合約關係。

與若干經銷商的經銷協議的主要條款包括：

主要條款	內容
持續時間	通常為兩年，可經雙方協議續期
地理區域	於協定區域內
付款、信貸額度和期限	特定訂單的任何付款條件應在訂單確認時指定
定價	產品的價格應按訂單以書面形式協定
產品退貨和質保	退貨及保修政策通常由雙方按具體訂單確定

業 務

主要條款	內容
分包合約	未經我們事先書面同意，我們不允許我們的經銷商分包、委派或以其他方式委聘與履行其合約責任有關的第三方服務

據我們所深知，我們所有經銷商均為獨立第三方。經銷商與本公司、其附屬公司、彼等的股東、董事、高級管理層、本公司的僱員或前僱員或彼等各自的任何聯繫人概無關連。據我們所深知，除與我們的一般經營經銷安排外，經銷商與本公司、我們的附屬公司、我們的股東、董事或高級管理層、本公司的僱員或前僱員或彼等各自的任何聯繫人概無其他關係。

營銷

我們在產品的不同應用領域與客戶建立了穩定且值得信賴的合作夥伴關係。例如，在產品銷售後，我們的技術團隊與客戶保持持續溝通，提供售後服務並了解彼等不斷變化的需求，以了解市場發展及趨勢以及我們產品當前的競爭格局。當我們開發出滿足客戶需求的產品時，我們會及時與他們溝通，以確保精準定位和留存客戶。通過利用我們強大的技術能力及創新產品，我們積極與行業夥伴合作，參加國際貿易會展，開展有針對性的促銷活動，以提高品牌知名度及佔領市場份額。此外，我們專注於通過卓越的售後服務及持續的產品改進，與客戶建立長期關係，從而鞏固我們等離子處理設備領先供應商的地位。

此外，我們積極組織或參與多項線上及線下營銷活動，如展覽、論壇及技術研討會，以滿足我們的業務推廣需求及提升我們的品牌知名度。隨著我們繼續在國內和全球擴張，我們將繼續優化我們的銷售和營銷網絡，以確保我們在現有和新市場擁有足夠的地理覆蓋。

定價

我們通過考慮多種因素為我們的產品定價，包括：(i)相關產品的成本，包括生產、研發開支及運營成本；(ii)客戶需求；(iii)過往交易價格；及(iv)競爭格局，其中考慮到我們相對於競爭對手的優勢及劣勢、彼等的定價策略及我們客戶的成本敏感度。

五大客戶

我們向各行各業的客戶提供產品，主要包括PCB、半導體及消費電子。於2023年、2024年及2025年，我們分別向中國內地及海外(主要包括東南亞、北美洲及歐洲)約134名、137名及150名客戶提供我們的產品及服務。

業 務

於2023年、2024年及2025年，來自我們最大客戶的收入分別佔我們於該等年度總收入的20.1%、19.0%及24.6%。於2023年、2024年及2025年，來自我們五大客戶的收入分別佔我們同年總收入的60.9%、51.5%及62.7%。

下表載列於往績記錄期間我們五大客戶的詳情：

截至2023年12月31日止年度

序號	客戶	背景	已售產品	收入	佔總收入的百分比	與我們開始業務關係的年份
1	客戶A.....	一家美國PCB製造設備及工藝解決方案供應商	用於PCB製造及其他應用領域的設備	27,803	20.1	2018年
2	客戶B.....	一家中國公司，主要從事LED及其他電子產品的製造與銷售。	用於PCB製造及其他應用領域的設備	19,510	14.1	2017年
3	客戶C.....	一家中國PCB製造商	用於PCB製造及其他應用領域的設備	14,461	10.4	2011年
4	客戶D.....	一家中國公司，主要從事集成電路及其他電子產品的製造與銷售。	用於半導體製造的設備	13,689	9.9	2017年
5	客戶E.....	一家總部位於美國的國際PCB製造商	用於PCB製造及其他應用的設備	8,825	6.4	2011年
	總計.....			84,288	60.9	

業 務

截至2024年12月31日止年度

序號	客戶	背景	已售產品	收入	佔總收入 的百分比	與我們開始 業務關係的年份
1	客戶F	一家於台灣交易所上市的公司，主要從事PCB的製造、加工及銷售	用於PCB製造及其他應用領域的設備	28,420	19.0	2013年
2	客戶G	一家中國公司，主要從事信息通訊技術基礎設施及智能設備的研發與製造。	用於半導體製造的設備	15,406	10.3	2019年
3	客戶A	一家美國PCB製造設備及工藝解決方案提供商	用於PCB製造及其他應用領域的設備	12,561	8.4	2018年
4	客戶B	一家中國公司，主要從事LED及其他電子產品的製造與銷售。	用於PCB製造及其他應用領域的設備	11,068	7.4	2017年
5	客戶D	一家中國公司，主要從事集成電路及其他電子產品的製造與銷售。	用於半導體製造的設備	9,573	6.4	2017年
	總計			<u><u>77,028</u></u>	<u><u>51.5</u></u>	

業 務

截至2025年12月31日止年度

序號	客戶	背景	已售產品	收入	佔總收入的百分比	與我們開始業務關係的年份
1	客戶F	一家於台灣交易所上市的公司，主要從事PCB的製造、加工及銷售	用於PCB製造及其他應用領域的設備	43,327	24.6	2013年
2	客戶C	一家中國PCB製造商	用於PCB製造及其他應用領域的設備	26,147	14.9	2011年
3	客戶D	一家中國公司，主要從事集成電路及其他電子產品的製造與銷售	用於半導體製造的設備	18,513	10.5	2017年
4	客戶A	一家美國PCB製造設備及工藝解決方案提供商	用於PCB製造及其他應用領域的設備	12,009	6.8	2017年
5	客戶B	一家中國公司，主要從事LED及其他電子產品的製造與銷售	用於PCB製造及其他應用領域的設備	10,301	5.9	2017年
	總計			<u>110,297</u>	<u>62.7</u>	

截至最後實際可行日期，概無董事、彼等各自的緊密聯繫人或任何擁有或據董事所知曾擁有我們已發行股本5%以上的股東於任何五大客戶中擁有任何權益。

售後服務、產品退貨及質保

我們有一個成熟而強大的客戶服務部，提供全面且響應迅速的客戶支持。我們的客戶服務部分為五個團隊，各個團隊負責以下地區：(i)華南及華中地區；(ii)華東；(iii)華北及西南地區；(iv)歐洲及北美洲；及(v)亞太地區。我們通過我們的網站、電話和電子郵件接收客戶反饋。

一旦我們向客戶交付產品，我們的客戶服務部將跟進安裝及調試過程，並確認產品的使用狀況。我們將指派專門的技術人員對我們的產品進行免費季度檢驗，向客戶提供檢驗報告，並根據客戶需求為潛在的新訂單提供相應的報價。我們的銷售部門隨後將跟進客戶的新訂單，直至該訂單完成。

此外，如果我們的客戶服務部或銷售部門收到客戶的維護請求，並且訂單仍在質保期內，客戶服務團隊將直接處理該請求。我們通常為產品提供一至兩年的質保期。如果訂單超出

業 務

質保期，團隊將向客戶提供維修費用表。一旦客戶確認，客戶服務團隊將安排將產品送到我們的工廠進行維修，並發出維護服務訂單。隨後，銷售部門將根據服務訂單提供正式報價，並跟進直至維修訂單完成。

我們提供量身定製的產品退貨和換貨服務，以滿足客戶的要求及解決其顧慮。我們制定了標準產品退貨程序，詳情載於我們的客戶退貨管理政策。當客戶對我們的產品提出質量問題時，我們的技術團隊將及時核實問題。在內部分分析和審查確認產品缺陷後，我們的業務部門將通知客戶服務團隊發起退貨請求以完成退換貨程序。於往績記錄期間，我們並無經歷任何重大產品退貨或換貨。

採購和供應鏈管理

原材料和採購

我們從供應商處採購用於製造產品的各種材料，包括鋁材、真空泵及射頻發生器等。我們的採購計劃乃根據存貨水平及市場供應情況而制定。採購計劃獲批准後，我們的採購部門通常將進行詢價，根據包括價格、質量及交貨時間等在內的標準評估潛在供應商。我們仔細考慮市場供應情況，並與供應商戰略磋商以確認我們的採購條款。這種方法確保了我們最大限度地有效管理及優化我們的成本。我們主要對我們的主要供應商進行直接評估及二手來源評估，以減輕對我們原材料成本的影響。

於往績記錄期間，我們的業務並無受到主要原材料價格波動的重大影響，且我們並無遇到任何原材料短缺導致生產中斷的情況。有關我們原材料的價格變動，請參閱本文件「行業概覽 — 競爭格局 — 成本分析」。我們認為，我們與供應商的穩定關係將繼續確保充足、穩定的原材料供應，有助於控制未來價格波動。於往績記錄期間，我們的原材料並無出現嚴重影響我們運營的質量問題。

供應商篩選及管理

於往績記錄期間，我們主要向供應商採購原材料及設備零部件。我們通常委聘經驗豐富的供應商以確保我們的產品質量。可能影響我們篩選的因素主要包括資質、資格、聲譽、價格、產品質量及交付能力。

我們實施嚴格的供應商管理程序。通過市場調查、線上搜索及推薦，我們建立了自身的潛在供應商池。潛在供應商在獲准加入我們的合資格供應商名單前須接受全面評估。一旦彼等成為我們的合資格供應商，我們的採購部門將與彼等磋商以決定採購條款。我們定期評估供應商表現，並制定了包括產品質量和準時交付在內的績效評估標準，以淘汰表現不佳的供應商，並與高質量的供應商保持穩定的關係。

業 務

我們認為，我們的營運並不依賴任何特定供應商。於往績記錄期間，我們有多個供應商，以避免過度依賴任何供應商，且我們認為尋找到適合的替代供應商並無重大困難。

與香港中介公司的過往代理安排

於往績記錄期間，我們的海外銷售交易乃根據一項通過香港中介公司進行的歷史性訂約及結算安排（「代理安排」）進行。香港中介公司並非我們集團的成員，而是根據一份代理協議（經不時補充）（「代理協議」）獲委任為我們的銷售代理。根據代理協議，我們在實質及形式上仍為製造商及主事人。尤其是：(i)我們製造產品；(ii)我們在產品轉移至客戶前保留其控制權，並承擔相關存貨及信貸風險；(iii)我們釐定海外銷售的定價及主要商業條款；(iv)海外客戶通常安排在我們工廠以工廠交貨(EXW)方式提取貨物，並獨立處理付運及進口清關；及(v)我們仍對產品質量負責，並在適用的情況下直接向海外客戶提供保修及售後服務（而客戶可於需要時，派遣人員至我們珠海生產基地進行培訓及測試）。香港中介公司的角色僅限於在合約執行方面提供行政協助（按我們與相關海外分銷商／客戶協定的條款）及代我們收取貿易款項。其並不承擔產品擁有權或管有權，並無定價權，亦不承擔存貨風險。

在實際操作中，海外客戶以香港中介公司作為訂約方發出採購訂單或訂立銷售合約。定價、規格及保修條件均由我們釐定，並載於經香港中介公司發出的銷售文件中，而合約條款並無賦予香港中介公司超越其代理職能的任何額外權利或義務。

代理安排項下主要合約條款及定價

根據代理協議，香港中介公司獲委任為我們的海外銷售代理，負責(i)簽訂海外銷售合約及(ii)代表我們收取客戶款項，並將客戶款項（經扣除協定的代理費後）匯給我們。香港中介公司有權收取代理費，該費用將在客戶款項匯至本公司前從中扣除。

代理費乃按交易量基準釐定，包括(i)每年人民幣270,000元的固定款項（而2025財年為人民幣135,000元，此為僅截至2025年6月30日止六個月的按比例固定費用），(ii)相當於香港中介公司處理的銷售總值4%的部分，以及(iii)實際業務開支的報銷。於2023年、2024年及2025年，香港中介公司收取的代理費分別為人民幣1.6百萬元、人民幣1.1百萬元及人民幣0.5百萬元。如下文進一步論述，就2025年而言，由於代理安排於2025年7月終止，應付香港中介公司的代理費僅產生於該年上半年。於2025年下半年並無應付香港中介公司的代理費。2025年下半年的海外銷售乃透過香港寶豐堂半導體進行。

業 務

在實務操作中，海外客戶通常按與交付里程碑相關的方式分期結算（一般包括訂金及支付運輸／安裝時及／或於保證期屆滿或其他條件達成時的里程碑付款）。香港中介公司收取的客戶款項（經扣除協定的代理費後）會應我們的要求匯給我們。於2025年7月之前的往績記錄期間，我們透過香港中介公司進行的海外銷售由本集團根據國際財務報告準則第15號按主事人基準入賬，收入於貨品控制權轉移至客戶時按銷售總額確認。

於2025年2月，我們成立全資香港附屬公司香港寶豐堂半導體，以直接處理海外銷售事宜。詳情請參閱本文件「歷史、發展及公司架構 — 寶豐堂(香港)有限公司(Boffotto (Hong Kong) Limited，現稱Ermala Limited)的過往安排」。我們已採取必要的行政及營運步驟（包括開立銀行賬戶、注資及客戶協調），以確保海外銷售職能順利過渡。隨著代理安排於2025年7月終止，並過渡至透過本集團全資香港附屬公司直接進行海外銷售，與海外客戶的條款並無重大變動，且該過渡並未對我們的財務表現造成任何重大變動。

代理安排已於2025年7月全面終止。為處理代理安排項下的遺留應收款項及預付款項，香港中介公司及我們的執行董事、副總經理兼首席市場官趙公魄先生以香港寶豐堂半導體及本集團為受益人簽立一份轉讓及承諾契據，據此（其中包括）：(i)歷史應收款項及預付款項的所有權利、所有權及權益自2025年7月1日起轉讓予香港寶豐堂半導體；(ii)香港中介公司其後就該等應收款項或預付款項收取的任何款項，須存入一個獨立的信託賬戶，並連同對賬詳情匯至香港寶豐堂半導體；及(iii)香港中介公司與趙公魄先生共同及個別承諾，就協定收款期屆滿後最終未能收回的任何應收款項差額向本集團作出彌償。

於2023年、2024年及2025年12月31日，(i)香港中介公司已向海外客戶收取但尚未與我們結算的貿易款項（經扣除代理費總額約人民幣3.2百萬元後）分別約為人民幣27.6百萬元、人民幣41.3百萬元及零；及(ii)尚未自海外客戶收取的貿易應收款項分別約為人民幣6.9百萬元、人民幣9.8百萬元及人民幣0.9百萬元。

隨著代理安排終止及海外訂約與結算全面過渡至香港寶豐堂半導體，所有新客戶款項現時均直接匯至本集團控制的銀行賬戶，日後將不再經由第三方收款代理。

根據弗若斯特沙利文的資料，我們使用該服務供應商符合行業規範。董事認為，過往的代理安排屬過渡性質且在商業上合理，乃為應對海外客戶的商業要求而採用，並於日常及一般業務過程中按正常商業條款進行。董事亦認為，終止代理安排對本集團的財務業績或營運並無不利影響。詳情請參閱本文件附錄一會計師報告附註37。

業 務

五大供應商

於2023年、2024年及2025年，每年向我們五大供應商的採購額分別佔我們於該等年度總採購額的25.9%、30.7%及28.2%。於2023年、2024年及2025年，向我們最大供應商的採購額分別佔我們於該等年度總採購額的9.6%、10.7%及10.6%。

下表載列於所示年度按採購總額計我們五大供應商的若干資料：

截至2023年12月31日止年度

序號	供應商	背景	向我們提供的產品／服務	採購金額	佔採購總額的百分比	與我們開始業務關係的年份
				<i>人民幣千元</i>		
1	供應商A.....	一家於中國註冊成立的公司，從事真空泵及氣體壓縮機研發及生產等	設備零部件	5,344	9.6	2010年
2	供應商B.....	一家於中國註冊成立的公司，主要從事金屬產品批發及進出口	原材料	3,621	6.5	2010年
3	供應商C.....	一家於香港成立的公司，主要從事電子專用設備及零部件、機器人及自動化設備、電子材料及進出口貿易	設備零部件	2,103	3.8	2023年
4	供應商D.....	一家於中國註冊成立的公司，從事工業設備、零部件及測量儀器及耗材銷售等	設備零部件	1,695	3.1	2018年
5	香港中介公司 ..	一家於香港註冊成立的公司，主要從事提供代理服務	代理服務	1,616	2.9	2020年
	總計			14,379	25.9	

業 務

截至2024年12月31日止年度

序號	供應商	背景	向我們提供的產品／服務	採購金額	佔採購總額的百分比	與我們開始業務關係的年份
				人民幣千元		
1	供應商A.....	一家於中國註冊成立的公司，從事真空泵及氣體壓縮機的生產等	設備零部件	5,702	10.7	2010年
2	供應商B.....	一家於中國註冊成立的公司，主要從事金屬產品批發及進出口	原材料	4,585	8.6	2010年
3	供應商E.....	一家於中國註冊成立的公司，主要從事半導體器件、專用設備、機械、機械零部件、電子產品及金屬產品銷售以及半導體器件製造等	設備零部件	2,486	4.7	2021年
4	供應商F.....	一家於中國註冊成立的公司，主要從事商品及技術進出口、商業信息諮詢服務、電力轉換設備的製造、維護及銷售，以及通用機械的租賃和銷售	設備零部件	1,950	3.7	2021年
5	供應商G.....	一家於中國註冊成立的公司，從事機電設備、氣體壓縮機械及通用機械的銷售，以及通用設備的修理和製造等	設備零部件	1,597	3.0	2019年
	總計			16,320	30.7	

截至2025年12月31日止年度

序號	供應商	背景	向我們提供的產品／服務	採購金額	佔採購總額的百分比	與我們開始業務關係的年份
				人民幣千元		
1	供應商A.....	一家於中國註冊成立的公司，從事真空泵及氣體壓縮機研發及生產等	設備零部件	7,522	10.6	2010年
2	供應商B.....	一家於中國註冊成立的公司，主要從事金屬產品批發及進出口	原材料	5,496	7.7	2010年
3	供應商F.....	一家於中國註冊成立的公司，主要從事商品及技術進出口、商業信息諮詢服務、電力轉換設備的製造、維護及銷售，以及通用機械的租賃和銷售	設備零部件	2,522	3.5	2021年
4	供應商H.....	一家於中國註冊成立，專門從事精密機械製造的高技術企業	用於PCB製造的輔助設備	2,377	3.3	2025年
5	供應商I	一家於中國註冊成立的公司，主要從事批發及零售貿易(特許經營類別除外)、電氣機械測試服務及能源技術諮詢服務	AD模塊、數字輸入模塊	2,201	3.1	2018年
	總計			20,118	28.2	

業 務

我們的執行董事趙公魄先生於往績記錄期間全資擁有香港中介公司。香港中介公司乃為趙公魄先生本身的業務活動而成立，且經董事確認，並無影響香港中介公司於其日常運營或與本集團的商業關係中的獨立性。本集團與香港中介公司的所有交易均按公平交易原則進行。香港中介公司對本集團的採購決策或供應商選擇並無任何不當影響。於2023年，香港中介公司向我們提供的代理服務金額為人民幣1.6百萬元。詳情請參閱本節「— 供應商篩選及管理」。

於往績記錄期間，我們與上述供應商並無任何重大糾紛。

董事確認，於往績記錄期間，除執行董事全資擁有的香港中介公司外，五大供應商概無與本公司及附屬公司、彼等的股東、董事、高級管理層監事或彼等各自的任何聯繫人有任何過往或現時關係。除上文所披露者外，概無董事、彼等的緊密聯繫人或就董事所深知擁有本公司已發行股本5%以上的任何股東於往績記錄期間每年於五大供應商中擁有任何權益。

物流及存貨管理

我們的存貨主要包括原材料、半成品及產成品。我們已制定標準政策以確保有效的存貨管理。例如，我們要求所有進貨庫存接受檢查和核實。質量控制部門定期對存貨進行質量檢測。我們的存貨管理部門每月進行盤點。我們的財務人員進行隨機檢查和核實。我們定期分析存貨水平，並於每個財政年度末編製年度存貨檢查報告，以便我們能夠及時處理滯銷存貨。於2023年、2024年及2025年，我們的存貨週轉天數分別為333天、264天及259天。請參閱「財務資料—綜合財務狀況表選定項目之討論—存貨」。

截至最後實際可行日期，我們所有的倉庫均由我們自身擁有，這使得我們的物流運營能夠更好地控制和提高效率。此外，我們的供應商承擔物流成本，這使我們能夠維持具有成本效益的供應鏈。

質量控制

我們非常重視實現和保持高標準的製造。我們相信，我們優質可靠的產品及服務的聲譽一直是吸引及挽留我們尊貴客戶群的關鍵。

我們根據ISO9001質量管理標準建立了全面的質量控制體系，涵蓋質量管理職能的分配、應對風險的措施、產品及服務的質量控制、審查及改進、以及詳細的生產流程圖，以確保我們產品及服務的持續優質。

業 務

我們擁有一個專門的團隊監督我們的質量控制流程。他們與我們的客戶服務團隊合作，及時提供客戶支持和售後服務。截至2025年12月31日，我們的質量控制部門有三名人員。我們經常舉辦有關質量管理體系及產品質量知識和技能的培訓及內部競賽，以進一步激勵員工致力於有效的質量控制。

由於我們執行嚴格的質量控制政策，於往績記錄期間及直至最後實際可行日期，我們並無出現任何重大產品退貨、申索、召回或撥備，突顯了我們產品的可靠性。

信息技術和數據安全

信息技術系統

信息技術是我們競爭優勢和運營效率的基礎。我們利用和維護隨著業務增長而發展的信息技術系統，確保它們滿足我們不同的運營需求。該等系統支持銷售、研發、供應鏈管理、生產及售後服務等關鍵領域，包括但不限於貫穿我們業務運營的企業資源計劃(ERP)系統及辦公自動化(OA)系統。

我們的信息技術基礎設施的功能和穩定性對我們的業務運營至關重要。信息技術部門進行系統檢查、數據備份、系統維護和其他活動，以確保關鍵信息技術系統和設施的持續運行。於往績記錄期間及直至最後實際可行日期，我們並無經歷任何對我們的業務營運造成重大不利影響的重大信息技術系統故障或停機。請參閱「風險因素 — 與行業及業務相關的風險 — 安全漏洞及其他干擾可能會損害我們的機密及專有信息，這可能會對我們的業務及聲譽造成損害」。

數據安全和隱私

近年來，數據隱私和網絡安全已成為全球公司的關鍵治理優先事項。由於中國立法機關及政府機關定期推出新的網絡安全、數據安全及隱私法律法規，這一點尤為重要。因此，我們在收集、使用、存儲、披露和傳輸各種類型數據方面的做法可能會受到更嚴格的行政審查。請參閱「風險因素 — 與行業及業務相關的風險 — 安全漏洞及其他干擾可能會損害我們的機密及專有信息，這可能會對我們的業務及聲譽造成損害」。

在我們的業務運營過程中，我們收集、存儲和處理業務數據和交易數據。鑒於我們與企業進行交易，我們的運營主要涉及向客戶、供應商等機構合作夥伴收集其聯絡人之個人信息。

為加強我們的數據安全及保護措施，我們已制定全面的內部政策。一般而言，我們已制定一套內部政策，涵蓋個人信息保護與管理措施、數據安全管理、網絡安全管理方案及

業 務

數據分類分級。就組織架構而言，我們已建立網絡安全、數據安全及個人信息保護管理部門之架構。同時，我們已開展與網絡安全、數據安全及個人信息保護相關的教育培訓方案。此外，我們亦採取下列安全措施：

- 數據安全。我們建立了一套數據安全協議，包括弱點掃描與監控、存取權限管理、冗余策略和備份策略，以防止意外數據丟失。我們亦在解決方案中利用加密技術來確保數據的真實性、完整性和可問責性。
- 基礎設施物理安全。我們的信息基礎設施已部署在我們的當地儲存中心，具備物理安全、硬件安全、軟件和網絡安全的專業防護能力。
- 網絡安全。我們採用了冗余網絡結構，安裝了專業的負載均衡設備，以保證網絡的穩定性。我們還在關鍵位置建立探測和防禦設備，以監控和防禦網絡攻擊。我們安排人員定期進行網絡檢查、升級網絡結構並執行病毒和漏洞掃描。
- 隱私保護。我們實施客戶信息和數據的分級保護，應用包括訪問授權、加密存儲和去標識化的隱私措施，防止個人隱私信息丟失或洩露。同時，我們建立了完善的隱私管理機制，在軟件開發、系統使用、日常巡檢、應急響應等不同場景下，提供全方位的個人隱私信息保護。

競爭

中國PCB市場由2020年的人民幣2,520億元增加至2025年的人民幣3,692億元，期內複合年增長率為7.9%。預期該市場將以5.8%的複合年增長率增長，並於2030年達到人民幣4,901億元。中國市場的PCB等離子處理設備市場相對分散，按收入計，前三名參與者於2025年佔據13.0%的市場。按2023年至2025年各年度於中國產生的收入計，我們在中國PCB等離子除膠渣設備市場排名前三。按2025年於中國產生的收入計，我們在中國PCB等離子處理設備市場的市場份額約為3.6%。

全球半導體產品行業蘊藏巨大的市場機遇。於2020年至2025年，全球等離子處理設備市場規模由人民幣1,798億元增加至人民幣3,479億元，複合年增長率為14.1%，預計於2030年將進一步達到人民幣5,283億元，2025年至2030年的複合年增長率為8.7%。有關我們運營的市場及面臨的競爭的詳細討論，請參閱本文件「行業概覽」。

業 務

僱員

截至2025年12月31日，我們共有209名僱員。下表載列截至2025年12月31日我們按職能分類的僱員人數。

職能	僱員人數
供應及製造	84
銷售及營銷	48
研發	52
一般及行政	25
總計	209

為簡化人力資源管理，我們制定了一套全面的內部管理措施，概述了招聘、培訓、內部轉介等的程序及標準。

我們採用多種招聘方式，包括校園招聘、線上招聘、其他外部招聘渠道以及內部推薦及調動。除薪金及福利外，我們一般為全職僱員提供按表現釐定的花紅。我們已建立全面的僱員培訓及發展體系，包括涵蓋企業文化、僱員權利及義務、工作場所安全、數據安全及其他物流方面的一般培訓，以及提升僱員於若干與我們業務相關的重要領域的知識及專業技能的特定培訓。我們持續致力於為僱員營造富有吸引力的工作環境。

我們與全職僱員訂立標準勞動合約及保密協議，並與主要管理層及專業技術人員訂立競業禁止協議。

根據中國法律法規的要求，我們參與由相關地方省市級政府組織的各項僱員社會保險計劃，包括住房、養老、醫療、工傷、生育及失業福利計劃。根據該計劃，我們並未足額繳納供款。考慮到於往績記錄期間及直至最後實際可行日期，(i)我們並未收到相關主管機關要求補繳社會保險及住房公積金短繳款項之任何通知，亦未收到任何重大員工投訴或就社會保險及住房公積金繳納事宜與員工發生任何重大爭議；(ii)經負責社會保險及住房公積金的地方政府主管機關或其授權單位確認，或經地方相關政府主管機關授權的信用機構出具的信用報告顯示，於往績記錄期間及截至最後實際可行日期，我們並未因社會保險及住房公積金繳納事宜受到重大行政處罰；及(iii)若我們收到相關主管機關要求於指定期間內整改、

業 務

繳納或補繳社會保險及住房公積金之通知，我們將立即遵守該等通知要求，我們董事認為，上述事件不會對我們業務、財務狀況及經營業績造成重大不利影響。依據人力資源和社會保障部、財政部、國家稅務總局及國家醫療保障局於2019年4月28日頒佈的《關於貫徹落實〈降低社會保險費率綜合方案〉的通知》及其他相關規定，禁止行政機關集中追繳企業歷史欠繳之社會保險費。

考量上述相關監管政策、監管確認文件及事實，假設(i)現行有關社會保險及住房公積金的政策及法規，以及相關主管機關對其的執行與監管要求未發生重大變動，及(ii)無任何組織或個人就我們未為員工足額繳納社會保險及住房公積金的事項向主管機關舉報、投訴或提起相關訴訟或仲裁，我們的中國法律顧問認為，我們因往績記錄期間短繳上述費用而面臨(a)重大行政處罰，或(b)社會保險主管機關集中追繳歷史欠費的可能性甚低。

我們相信，我們與僱員維持良好的工作關係，且於往績記錄期間及直至最後實際可行日期，我們的經營並未遇到任何重大勞資糾紛或任何員工招聘方面的困難。

保險

截至最後實際可行日期，我們認為我們的保險範圍符合行業慣例，且足以覆蓋我們的主要資產、設施及負債，包括但不限於財產一切險。董事認為，我們的保險政策整體上符合一般市場慣例，並符合中國內地的相關規則及法規。請參閱「風險因素 — 與行業及業務相關的風險 — 對於我們可能面臨的責任或損失，我們的投保或許並不足以覆蓋，因此，倘出現任何此類責任或損失，我們的業務、財務狀況、經營業績及前景可能會受到重大不利影響」。

季節性

於往績記錄期間，我們並無受到重大季節性影響。有關我們原材料的價格變動，請參閱本文件「行業概覽 — 競爭格局 — 成本分析」。

環境、社會及管治

我們致力打造可持續發展的業務，並密切關注環境、社會及企業管治(「ESG」)事宜。我們已將可持續發展等ESG要素融入我們業務的各個方面。一方面，我們已將ESG考量融入業務。另一方面，我們不斷強化社會責任體系，履行環保責任，推行綠色辦公與低碳實踐。我們相信我們的政策足以確保遵守所有健康、安全、社會及環境保護法規。我們旨在優化我們的ESG策略，且我們的董事將積極參與設計我們的ESG策略及目標，並將評估、釐定及解決我們與ESG相關的風險。

業 務

管治

我們知悉我們的環境保護及社會責任，並知悉可能影響本集團業務營運與氣候相關的問題。我們承諾於[編纂]後遵守ESG報告規定。我們致力於通過踐行節能及可持續發展的理念，減少對環境的負面影響。我們預計將根據上市規則附錄C2所載標準制定ESG政策，涵蓋(其中包括)(i)ESG管治架構及ESG策略制定程序，(ii)ESG風險管理及監控，及(iii)確定關鍵績效指標、相關指標及緩解措施。

我們的ESG政策將載列不同各方在管理ESG事宜方面各自的責任及權限。我們的董事會為我們在ESG問題上的最高決策及管理機構。其將全面負責監督及釐定影響本集團的環境、社會及氣候相關風險以及機遇，制定及採納本集團ESG政策及目標，並每年根據ESG目標檢討本集團表現，倘發現與目標有重大差異，則酌情修訂ESG策略。

在董事會的監督下，我們將積極識別及監控ESG相關風險對我們的業務、策略及財務表現的實際及潛在影響，並將該等問題的考量納入我們的業務、策略及財務規劃。我們亦將環境保護作為僱員培訓的重要內容，並持續提升本集團全體僱員的節能環境保護意識，助力我們實現綠色、健康、可持續發展。

我們須遵守中國內地多項ESG相關法律及法規，且我們的營運定期接受地方政府部門的檢查。有關進一步詳情，請參閱本文件「監管概覽—環境保護法規」。

於往績記錄期間及直至最後實際可行日期，我們並無收到與嚴重違反任何環境法律或法規有關的任何罰款或處罰。據董事所深知及確信，我們毋須承擔重大環境責任風險，且日後不會產生重大合規成本。

鑒於我們的業務性質，就董事所深知，氣候變化不會對我們的業務營運造成任何重大影響。如遇極端自然天氣，我們將積極響應地方政府的相關政策，並制定應急預案以確保員工安全。如出現極端天氣事件導致的資產直接受損及供應鏈中斷的間接影響等嚴重實際風險，我們將制定相應的應急及備災計劃，我們相信我們有能力應對氣候危機。於往績記錄期間及直至最後實際可行日期，我們並無因環境、社會及氣候相關問題而對我們的業務營運、策略或財務表現造成任何重大影響。

業 務

ESG相關風險評估指標及目標

我們致力於以保護環境的方式運營我們的設施。於往績記錄期間及直至最後實際可行日期，概無因違反環境法律及法規而對我們的業務、財務狀況或經營業績造成重大不利影響的重大申索或罰款。於2025年，我們就環境合規事宜支付款項人民幣23,120元。

就本集團而言，我們始終認識到環境及社會責任的重要性，並致力於在我們作為營利性公司的角色與我們促進社會福祉的責任之間取得平衡。我們的業務對環境及氣候的直接影響主要來自資源消耗，包括電力及水資源消耗。下表載列我們於往績記錄期間的主要能源消耗數據：

	截至12月31日止年度		
	2023年	2024年	2025年
電力消耗(千瓦時).....	840,467	1,196,392	1,023,955
水資源消耗(噸).....	3,980	4,650	5,728

我們深知節約能源及節約資源的重要性。因此，我們亦已實施相關內部政策，以減少我們對環境的影響及碳足跡，主要包括：(i)定期向僱員發送節能提醒，敦促其在離開辦公室或生產中心後及下班前及時關閉室內燈光、電子設備及空調；(ii)設立廢紙簍，以回收可重複使用的紙張(如只使用了一面的紙張)；(iii)鼓勵使用線上系統收集銷售訂單，並減少紙質文件的使用；(iv)鼓勵盡可能採用對環境造成最小影響的材料；(v)在我們的辦公區打造「無煙」環境，並在室外設有綠色花園以淨化空氣；及(vi)推行精準垃圾分類、提供回收設施並定期清理，以實現資源回收。到2029年，我們的目標是實現每單位收入的電力消耗及水資源消耗減少10%。

健康、安全及社會責任

我們致力為僱員提供安全及健康的工作環境。我們已實施一項關於安全及事故的政策，涵蓋辦公室及生產設施安全政策、惡劣天氣條件安排及消防安全。為確保遵守適用法律及法規，如有需要及經諮詢法律顧問後，我們會不時調整我們的人力資源政策，以適應相關勞動及安全法律法規的重大變動。

除提供安全及健康的工作環境外，我們亦採取多項措施維持安全及可持續發展的環境。我們實施安全指引以載列有關潛在安全危害的資料。此外，我們已制定政策並採取相關措

業 務

施以確保工作環境衛生及僱員健康。由於我們並無經營任何生產設施，我們並無面臨重大健康、工作安全、社會或環境風險。為確保符合適用法律及法規，我們的人力資源部將於必要時及諮詢我們的法律顧問後調整我們的人力資源政策，以適應相關勞動及安全法律及法規的重大變動。

在社會責任方面，我們致力於為僱員提供公平及關愛僱員的工作環境。我們重視每位僱員在不同崗位上的貢獻，並努力提供公平的薪酬計劃，以提供適當的激勵。我們根據僱員的優點聘用僱員，我們的公司政策是為僱員提供平等機會，不論性別、年齡、種族、宗教或任何其他社會或個人特徵，並提供培訓計劃以使我們的僱員緊跟行業及監管發展。我們的僱傭政策以公平分配工作及同工同酬的原則為基礎。我們維護僱員的尊嚴，並對基於性別、種族、宗教、年齡或任何其他因素的歧視保持零容忍政策。我們完全遵守適用勞動法，與僱員訂立個人僱傭合約。這些合約全面涵蓋了工資、花紅、僱員福利、工作場所安全、保密義務及終止理由等基本事項。

我們的員工組成反映了我們對多元化的承諾。截至2025年12月31日，我們的僱員中約有16.7%為女性，而83.3%為男性。在年齡方面，我們的員工中有20.1%年齡在30歲以下，44.5%年齡在30至40歲之間，34.9%年齡在40歲以上。

於往績記錄期間及直至最後實際可行日期，我們並無發生任何重大事故、人身或財產損害索償或僱員賠償，且我們並無因不遵守健康、工作安全、社會或環境法規而遭受任何罰款或其他處罰。

物業

我們的公司總部位於廣東省珠海市。截至最後實際可行日期，我們於廣東省珠海市擁有一項物業，總建築面積為172.85平方米，主要用作商業及辦公用途。此外，我們擁有兩幅土地的土地使用權：一幅位於廣東省珠海市，總建築面積為26,509.31平方米，將於建設完成後用作我們的新總部，另一幅位於浙江省衢州市，總建築面積為27,913.00平方米，擬用作新生產廠房。截至最後實際可行日期，我們有10項租賃物業，總建築面積為12,985.82平方米。我們的租賃物業主要用作辦公場所、生產基地及僱員宿舍。

截至最後實際可行日期，我們租賃的兩處物業的出租人尚未提供業權契據，而我們租賃的其他三處物業的出租人尚未提供相應業主的租賃授權證明或其他共有人書面同意租賃的確認文件。儘管我們的租賃物業缺乏若干業權證書或物業擁有人的租賃授權證書或確認其他共同擁有人書面同意租賃的相關文件，但該等租賃物業易於更換，且不作為我們的主要生產及經營場所。

截至最後實際可行日期，我們已根據中國內地適用法律法規就該等租賃樓宇向相關主管機關，完成三份租賃協議的登記。誠如我們的中國法律顧問告知，未能向相關中國政府機關登記該等租賃協議不會影響相關租賃協議的有效性及可執行性，惟相關中國政府機關

業 務

可能責令我們或出租人於指定時限內登記租賃協議。倘未在時限內完成登記，我們可能會就每份未登記租賃協議被處以介乎人民幣1,000元至人民幣10,000元的罰款。根據該等物業的數量及其所在城市，我們認為我們因未能對所有相關租賃協議進行登記備案而同時受到處罰的可能性甚微。

截至2025年12月31日，概無構成本集團物業業務一部分的單一物業權益的賬面值佔我們總資產的1%或以上，亦無構成本集團非物業業務一部分的單一物業權益的賬面值佔我們總資產的15%或以上。根據《公司(豁免公司及招股章程遵從條文)公告》第6(2)條，本文件獲豁免遵守公司(清盤及雜項條文)條例第342(1)(b)條關於須按公司(清盤及雜項條文)條例附表三第34(2)段規定在估值報告中載列所有土地或樓宇權益的規定。

有關我們租賃物業的風險，請參閱「風險因素 — 與行業及業務相關的風險 — 我們可能因在中國內地自有及租賃的現有物業存在缺陷而受到重大不利影響」及「風險因素 — 與行業及業務相關的風險 — 我們使用若干租賃物業的合法權利可能受到挑戰或限制」。

執照、許可證及批文

我們須接受當地監管機構的定期檢查、審查及審計，並須根據我們運營所在司法管轄區的法律法規，向政府機關取得各類許可證、執照、批文及證書。截至最後實際可行日期，我們已從相關機關取得對我們運營至關重要的必要執照、批文及許可證，且該等執照、許可證、批文及證書均屬有效及生效。

合規及法律訴訟

法律合規

於往績記錄期間及直至最後實際可行日期，我們在所有重大方面均已遵守與我們業務相關的適用法律及法規，且並無涉及任何董事認為會個別或共同對我們整體業務造成重大不利影響的不合規事件。

法律訴訟

於一般業務營運過程中，我們可能涉及合約糾紛、訴訟或其他法律程序。請參閱「風險因素 — 與行業及業務相關的風險 — 我們面臨與僱員、競爭對手、業務夥伴或其他方出現訴訟和糾紛有關的風險，這可能對我們的業務、財務狀況、經營業績及前景產生不利影響」。

業 務

截至最後實際可行日期，本公司、任何我們的附屬公司或任何董事概無涉及任何可能對本集團財務狀況或經營業績造成重大不利影響的重大訴訟、仲裁或申索。

風險管理及內部控制

風險管理

我們的運營面臨各種風險，因此風險管理對我們的業務至關重要。有關我們面臨的各種經營風險的詳情，請參閱本文件「風險因素」。此外，我們亦面臨不同的財務風險，例如日常業務過程中產生的外匯風險、現金流量及公允價值利率風險、信貸及流動資金風險。詳情請參閱本文件「財務資料 — 風險披露」。為識別、評估、控制及監察可能對我們業務造成阻礙的風險，我們已設計並實行政策及程序，以幫助確保在營運中進行有效的風險管理。

我們已採用一套全面的風險管理政策，其中載列風險管理框架，以持續識別、評估、評價及監察與我們的戰略目標相關的主要風險。我們的高級管理層和董事會監督我們風險管理政策的實施。管理層識別的風險將按可能性及影響進行分析，並將由本集團妥善跟進、減輕及糾正，以及向高級管理層報告。

為監察風險管理政策及企業管治措施的持續實施，我們已採取或將會採取(其中包括)以下風險管理及內部控制措施：

- 審計委員會將監督及管理與我們業務營運相關的整體風險，包括(i)審閱及批准我們的風險管理政策，以確保其與我們的公司目標一致；(ii)審閱及批准我們的企業風險承受能力；(iii)監察與我們業務營運相關的最重大風險及管理層對該等風險的處理；(iv)根據我們的企業風險承受能力審閱我們的企業風險；及(v)監察及確保我們的風險管理框架在本公司得到適當應用。有關該等委員會成員的資格及經驗以及審計委員會職責的詳細描述，請參閱本文件「董事及高級管理層 — 董事委員會 — 審計委員會」。
- 我們的首席執行官將負責(i)制定及維持有效的全面風險管理系統；(ii)釐定風險管理策略、風險管理政策、風險偏好及承受能力以及風險管理架構；(iii)確保我們的營運合法、合規及審慎；(iv)批准風險管理架構的建立及調整；(v)向高級管理層就我們的風險管理及評估提供指導。
- 我們已指定高級管理層人員負責(i)執行首席執行官的風險戰略和及風險管理政策；(ii)領導全流程風險管理建設，制定涵蓋風險識別、評估、控制、監察及報告的風險管理操作程序；(iii)識別我們運營中的潛在風險並採取相關風險管理措施；(iv)

業 務

向本公司各部門宣傳風險政策；及(v)向首席執行官報告我們的重大風險。

- 本公司的相關風險管理專業及相關部門負責執行我們的風險管理政策及開展日常風險管理實踐。為規範本公司風險管理並設定統一的透明度及風險管理表現水平，相關部門將(i)進行風險評估，包括識別、評估、監察、控制及報告可能影響其營運的風險；(ii)制定及維持適當機制以促進風險管理框架的應用；及(iii)定期編製風險管理報告。

我們認為，我們的董事會及高級管理層成員擁有必要的知識及經驗，可提供與風險管理及內部控制相關的良好企業管治監督。

內部控制

我們的董事會負責建立並確保有效的內部控制，以始終保護我們股東的投資。我們的內部控制政策制定了一個框架，以持續識別、評估、評價及監察與我們的戰略目標相關的主要風險。以下為我們已實施或計劃實施的內部控制政策、措施及程序概要：

- 我們已就運營的各個方面採取多項措施及程序，如知識產權保護、環境保護及職業健康與安全。作為僱員培訓計劃的一部分，我們定期向僱員提供有關該等措施及程序的培訓。我們亦於業務運營過程中透過高級管理層團隊定期監察該等措施及程序的實施情況。
- 我們的董事會（負責監察本集團的企業管治）將在法律顧問的協助下，於[編纂]後定期檢討我們遵守所有相關法律及法規的情況。
- 我們已成立審計委員會，該委員會將(i)就委任及罷免外聘核數師向董事會提出推薦建議；及(ii)審閱財務報表並就財務報告提供意見以及監督本集團的風險管理及內部控制程序。更多詳情請參閱「董事及高級管理層 — 董事委員會 — 審計委員會」。
- 我們已委聘一名合規顧問，向董事及管理層團隊提供有關上市規則相關事宜的意見，直至[編纂]後首個財政年度末為止。我們的合規顧問預期將確保我們於[編纂]後使用[編纂][編纂]符合本文件「未來計劃及[編纂]」一節，並就相關監管機構的規定及時提供支持及建議。

業 務

- 我們已委聘一家中國律師事務所就[編纂]後的中國法律法規向我們提供意見，並使我們及時了解中國法律法規的情況。我們將繼續在必要時安排由外部法律顧問及／或任何合適的認可機構不時提供各種培訓，向董事、監事、高級管理層及相關僱員更新最新適用的法律法規。
- 我們在銷售及營銷活動中對銷售及營銷人員及經銷商維持嚴格的反腐敗政策。我們亦監察以確保我們的銷售及營銷人員遵守適用的推廣及廣告規定，包括限制向未經批准的用途或患者群體推廣我們的產品（亦稱為超說明書使用），以及限制行業贊助的科學及教育活動。

於往績記錄期間，我們已定期檢討及加強我們的內部控制系統。我們認為，我們的董事及高級管理層成員擁有必要的知識及經驗，可提供與風險管理及內部控制相關的良好企業管治監督。

獎項及表彰

於往績記錄期間，我們就我們的產品、知識產權及研發能力獲得獎項及表彰，其中重要獎項及表彰載列如下：

獎項／表彰	獲獎年份	頒獎機構／部門
專精特新小巨人企業	2024年	中國工業和信息化部
廣東省科學技術獎.....	2024年	廣東省機械工程學會
中國創新創業大賽(廣東)暨「珠江天使杯」 科技創新創業大賽一等獎.....	2022年	中國創新創業大賽(廣東)組委會
中國創新創業大賽(廣東珠海)暨珠海市「科 創杯」創新創業大賽優勝獎.....	2022年	珠海創新創業大賽組委會

業 務

獎項／表彰	獲獎年份	頒獎機構／部門
中國半導體行業協會會員	2022年	中國半導體行業協會
高新技術企業	2021年	廣東省科學技術廳、財政廳、稅務局
中國半導體行業協會會員	2021年	中國半導體行業協會